

# 2022年3月期第2四半期 決算説明会

2021年11月12日

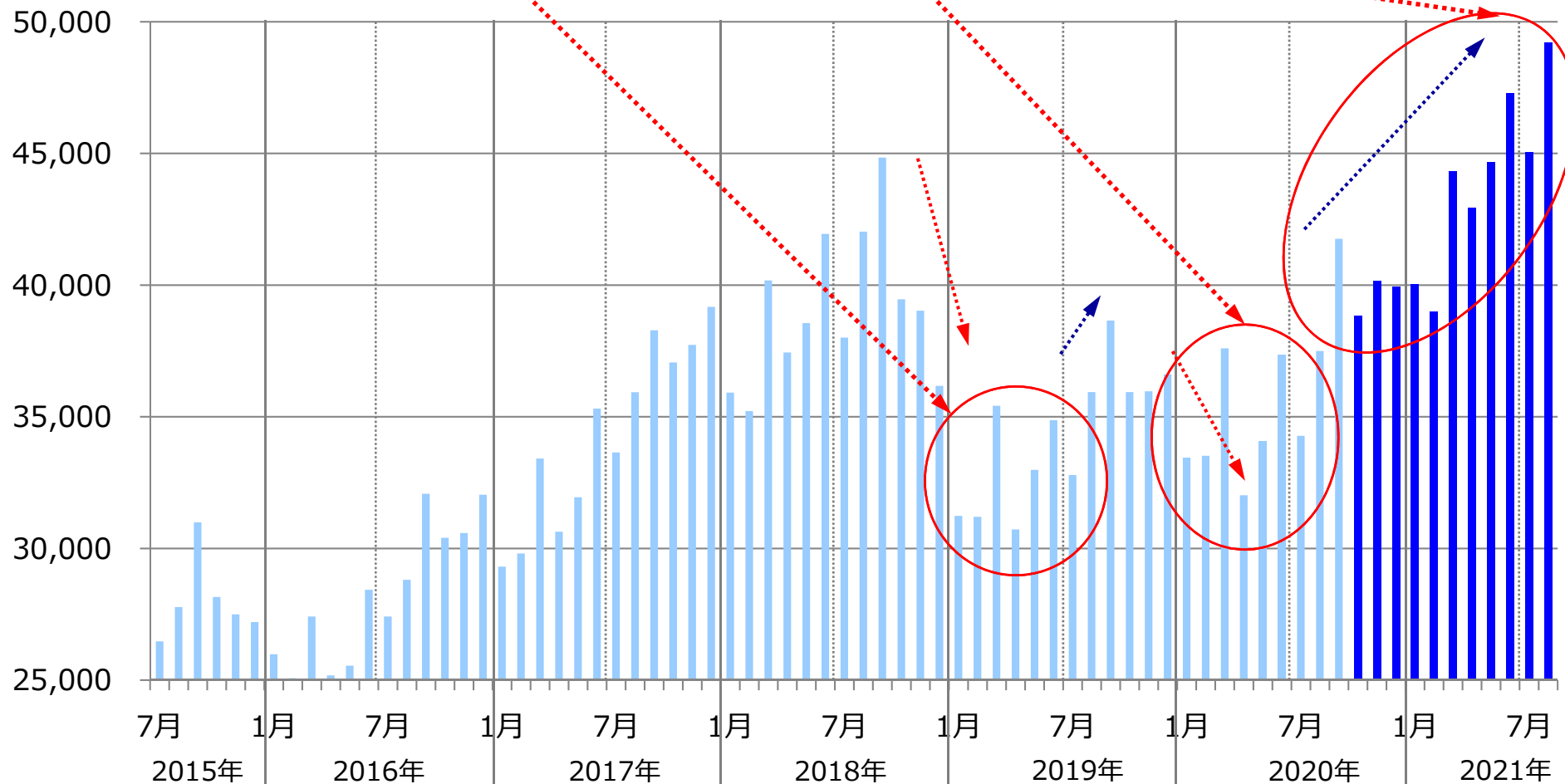
株式会社フジミインコーポレーテッド

# 市場概況

# 世界半導体市場動向（月次 実績 ※2021年8月まで）

- ・2019年1月から7月までの半年ほど、メモリバブルの反動で低迷後、北米、中国を中心に回復
- ・2020年1月より、新型コロナの影響で再び下降、同年4月で底打ち
- ・2020年8月以降、上昇に転じた後、非常に強い半導体需要が現在も継続

(単位：100万ドル)

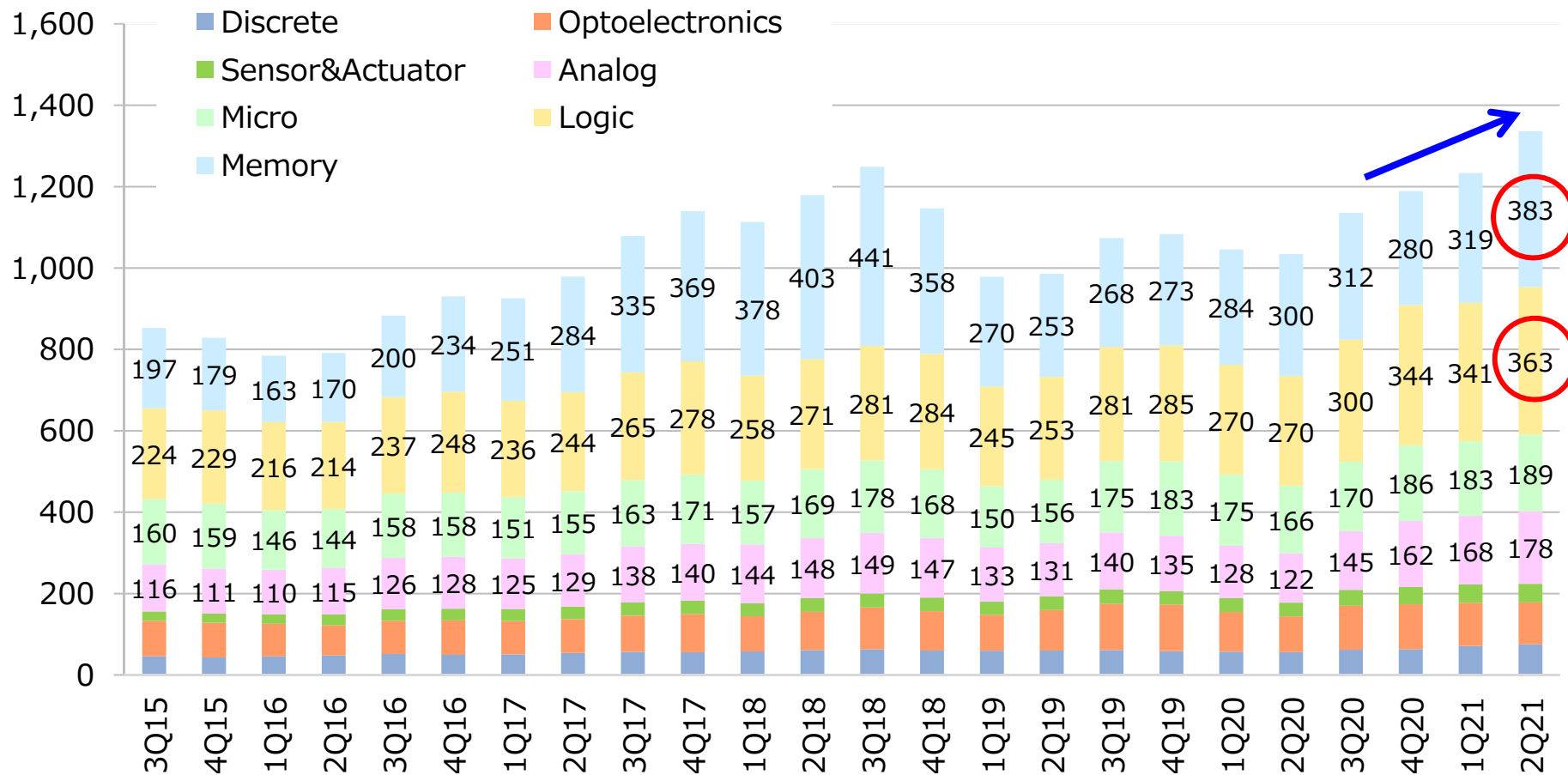


出所：WSTS (2021/10/1)

# 世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

・世界半導体市場は、2021年2Q（4-6月期）、ロジック、メモリともに好調

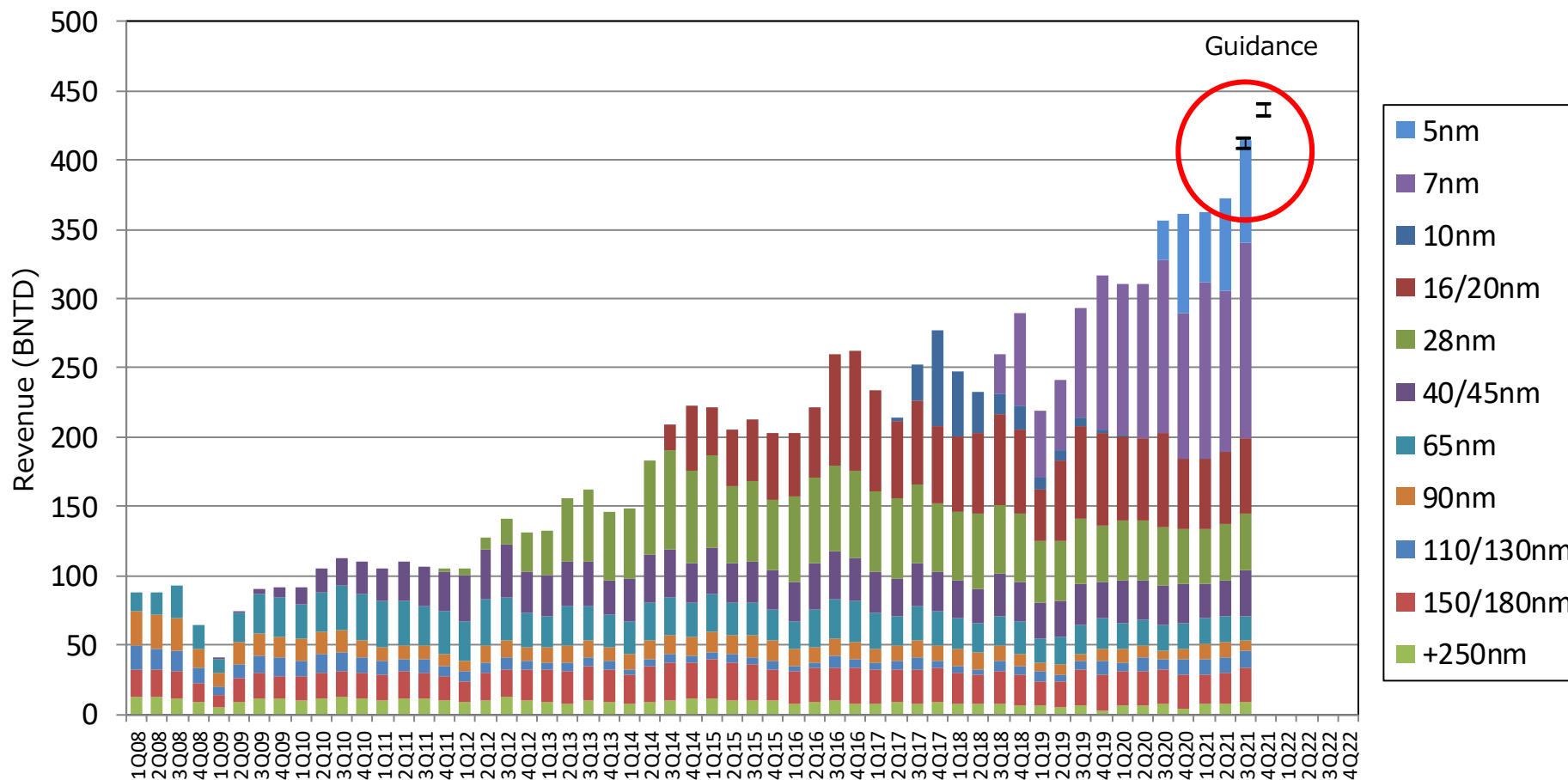
単位：億ドル



出所：WSTS

# 台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2021年7-9月期）

- ・21年1Q（1-3月期）に続き、2Q（4-6月期）3Q（7-9月期）いずれも売上高は過去最高を更新
- ・21年4Q（10-12月期）も過去最高を更新見込（ガイダンスベース）
- ・Node別売上高では5nm,7nmの最先端半導体デバイス向けだけでなく、28nm以前の従来型向けも増加



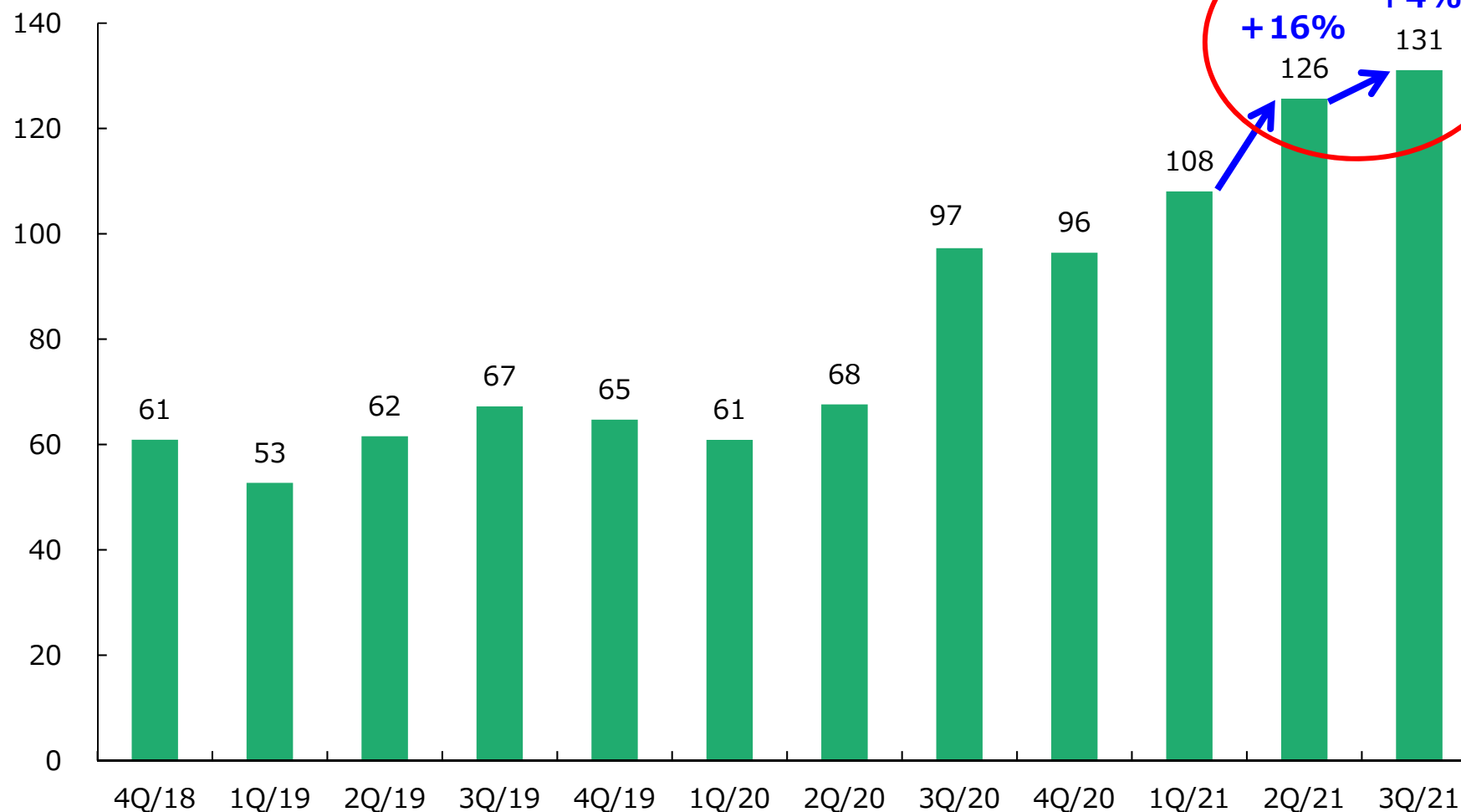
出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

《暦年ベース》

# メディアテック 売上高 (2021年7-9月期)

・5G製品の需要拡大に伴い、2021年2Q（4-6月期）の売上高はQoQ+16%、3Q（7-9月期）はQoQ+4%

売上高 (BNTD)

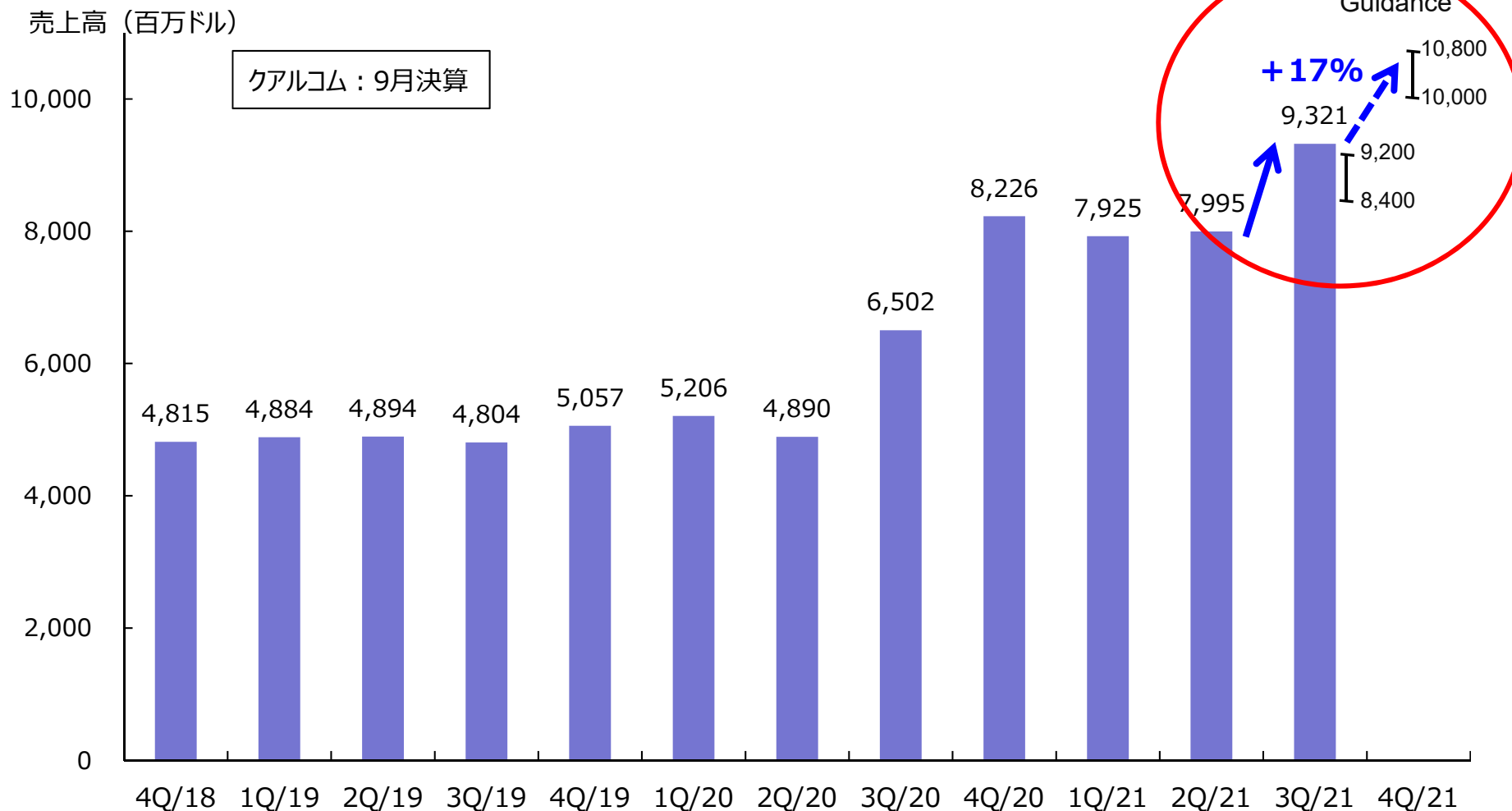


出所：メディアテック公開情報よりフジミ作成

《暦年ベース》

# クアルコム 売上高 (2021年7-9月期)

- ・2021年3Q (7-9月期) の売上高はQoQ+17%
- ・2021年4Q (10-12月期) のガイダンスでは、5G製品の更なる需要拡大に伴い、売上高を10,000～10,800百万ドルと見込む



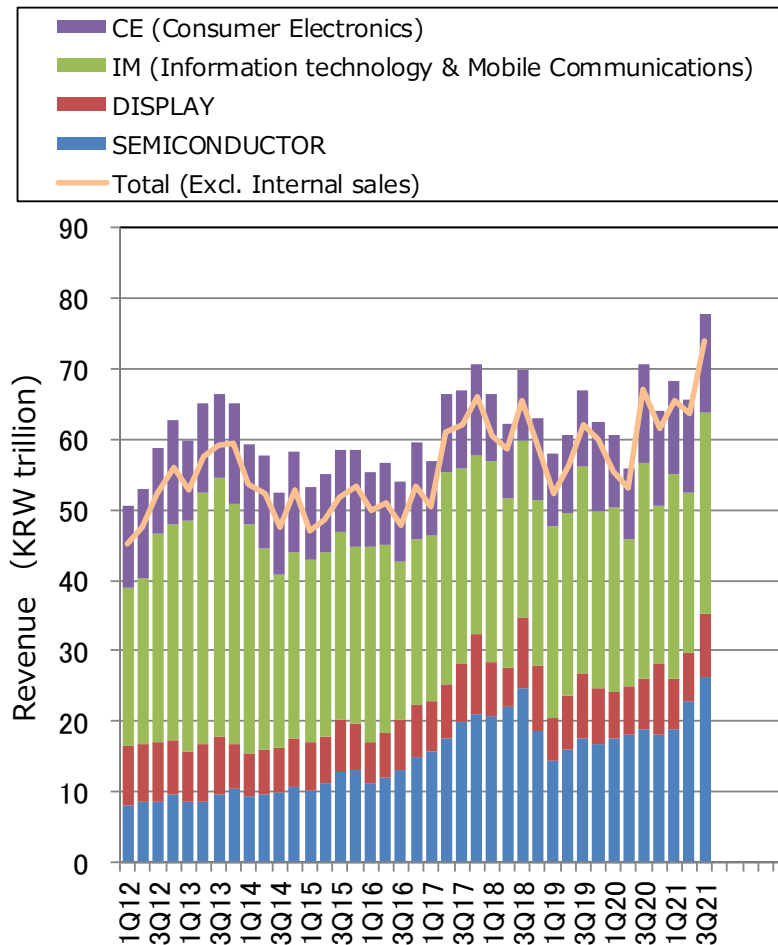
出所：クアルコム公開情報によりフジミ作成

《暦年ベース》

# サムスン電子 売上高 (2021年7-9月期)

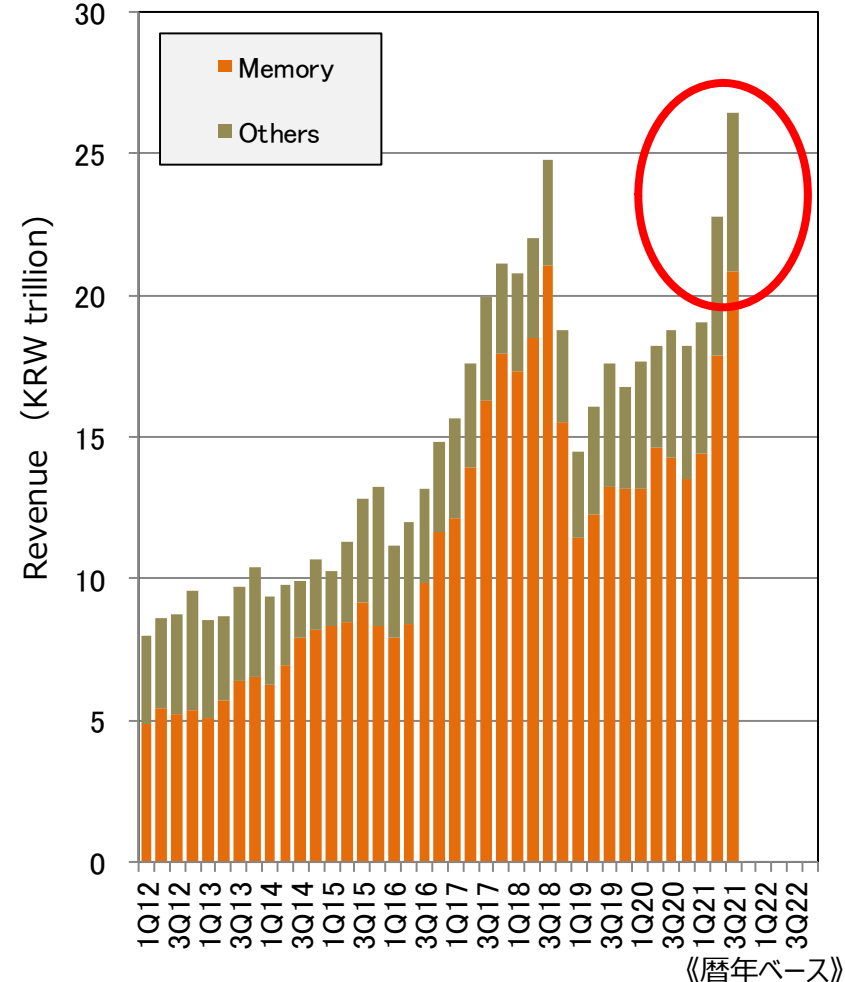
- ・半導体事業は、2021年3Q (7-9月期) 売上高が過去最高を更新
- ・DRAM、NANDともにサーバー向け等で堅調
- ・4Q (10-12月期) のメモリ事業に関しては、同社顧客の部品調達制約の影響を注視とのコメントあり

### <サムスン電子 全社 売上高>



出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

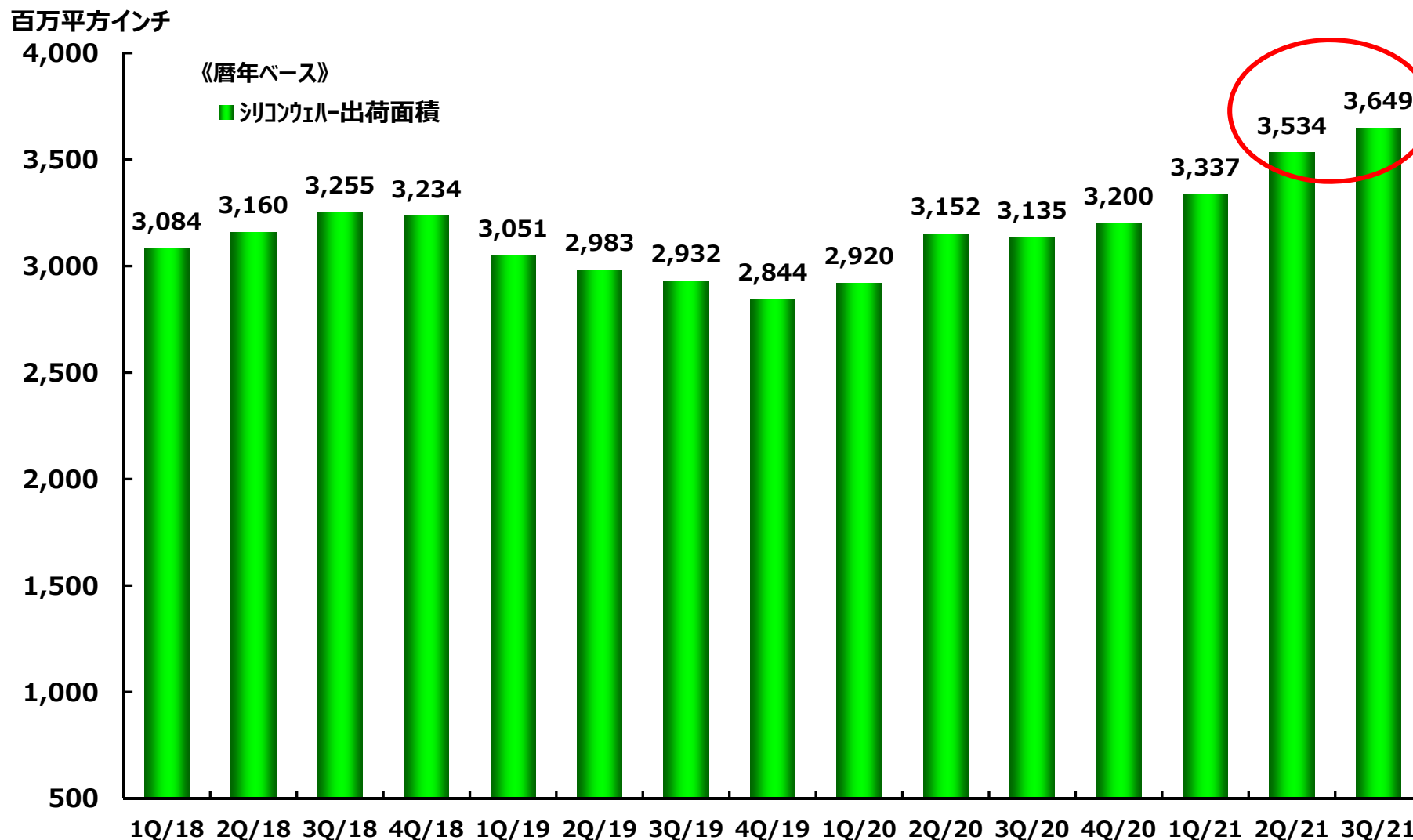
### <サムスン電子 半導体事業 売上高>





# シリコンウェハー出荷面積（四半期）

・シリコンウェハー出荷面積は、2021年1Qから引き続き、2Q、3Qいずれも、過去最高を更新



出所：SEMI (2021/11/5)

《暦年ベース》

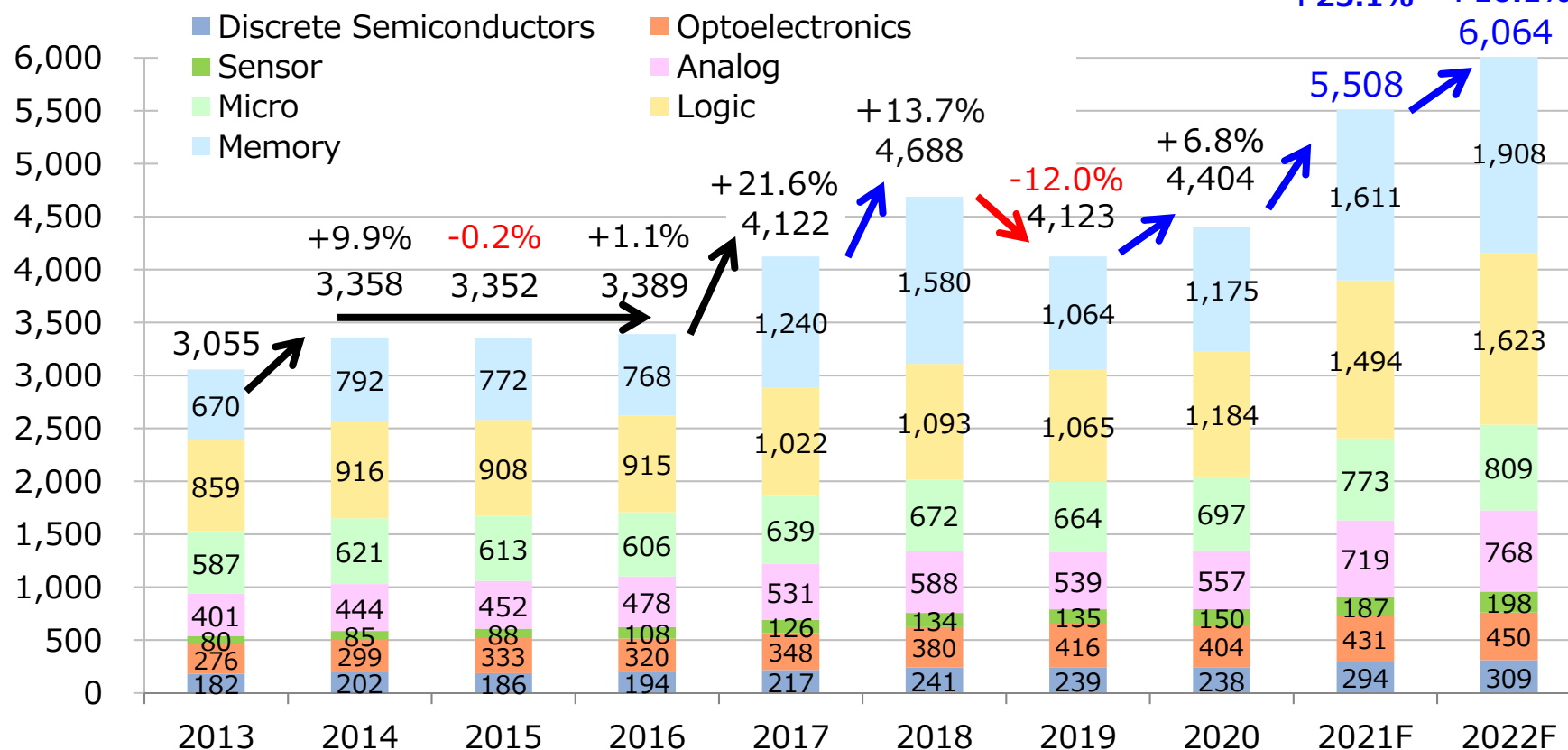
# 世界半導体市場動向（年次 実績/予測）

## 用途別

- ・WSTSによると、2021年予測（2021年6月時点）では、コロナ以降、ライフスタイルの変化や5Gスマホの増加が半導体需要を押し上げていることに加え、ワクチン接種の進展により経済活動の正常化も期待され、**+25.1%**と見込まれている
- ・2022年予測では、足元の非常に強い半導体需要が急速に弱まる要因が見当たらないことから、特に反動減を考慮せず、**+10.1%**の成長が見込まれている

2021/3/17 見直し	対前年増減	+10.9%	-
2021/6/8 見直し	対前年増減	+19.7%	+8.8%

単位：億ドル



出所：WSTS（2021/8/16）

## マクロ環境

- コロナ以降、ライフスタイルの変化や5Gスマホの増加が半導体需要を押し上げた
- ワクチン接種の進展により経済活動は緩やかながら正常化に向かった

## 半導体市場

- ロジック半導体 : 最先端半導体デバイス向けだけでなく、従来型半導体デバイス向けにおいても高稼働が継続（自動車向け半導体等については引き続き需給タイト）
- メモリ半導体 : 上期はデータセンター向けをはじめとするサーバ需要の増加に伴い、最先端分野が高稼働であった。（但し、足許では、一部メモリ半導体価格の下落が見られることに加え、エンド製品における部品調達制約のメモリ半導体への影響等、下期の生産動向に注視が必要）
- シリコンウェハー : 半導体需要が高水準で継続しており、出荷面積は過去最高を更新

## 非半導体市場

- 自動車、産業機械市場は、コロナ影響が深刻であった前年同期から回復（但し、半導体不足による自動車生産調整の影響については、引き続き注視が必要）

# 決算概要

# 決算概要 (上期実績)

単位：百万円	21年3月期		22年3月期						
	上期実績	下期実績	上期予想 ('21/5)	上期予想 ('21/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	上期予想比 ('21/5)	上期予想比 ('21/8)
売上高	20,427	21,529	21,000	24,500	<b>25,291</b>	<b>+23.8%</b>	<b>+17.5%</b>	<b>+20.4%</b>	<b>+3.2%</b>
営業利益	3,718	3,920	3,800	5,500	<b>6,158</b>	<b>+65.6%</b>	<b>+57.1%</b>	<b>+62.1%</b>	<b>+12.0%</b>
率	18.2%	18.2%	18.1%	22.4%	<b>24.4%</b>	-	-	-	-
経常利益	3,694	4,015	3,850	5,600	<b>6,357</b>	<b>+72.1%</b>	<b>+58.3%</b>	<b>+65.1%</b>	<b>+13.5%</b>
率	18.1%	18.7%	18.3%	22.9%	<b>25.1%</b>	-	-	-	-
四半期純利益	2,855	2,752	3,000	4,200	<b>4,803</b>	<b>+68.2%</b>	<b>+74.5%</b>	<b>+60.1%</b>	<b>+14.4%</b>
率	14.0%	12.8%	14.3%	17.1%	<b>19.0%</b>	-	-	-	-

・売上高、利益ともに前年同期比で大幅増加

・上期業績の背景：

- コロナ感染症拡大による生活様式の変化に伴う情報通信の高度化に対応する最先端半導体デバイスの需要増加
- 自動車向け等の従来型半導体デバイスも需要回復
- 最先端半導体デバイス向け製品の売上が増加し、製品構成が良化

# 業績予想（下期予想）

単位：百万円	21年3月期		22年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想('21/5)	下期修正予想('21/11)	前年同期比	同年上期比	予想比('21/5)
売上高	20,427	21,529	25,291	22,500	<b>24,708</b>	<b>+14.8%</b>	△2.3%	<b>+9.8%</b>
営業利益 率	3,718 18.2%	3,920 18.2%	6,158 24.4%	4,700 20.9%	<b>5,341</b> <b>21.6%</b>	<b>+36.2%</b> -	△13.3% -	<b>+13.6%</b> -
経常利益 率	3,694 18.1%	4,015 18.7%	6,357 25.1%	4,750 21.1%	<b>5,392</b> <b>21.8%</b>	<b>+34.3%</b> -	△15.2% -	<b>+13.5%</b> -
四半期純利益 率	2,855 14.0%	2,752 12.8%	4,803 19.0%	3,200 14.2%	<b>3,996</b> <b>16.2%</b>	<b>+45.2%</b> -	△16.8% -	<b>+24.9%</b> -

- 売上高、利益ともに前年同期を大幅に上回るも、上期実績を下回る
- 想定為替レート：105円/ドル（上期実績 110円/ドル）
- 下期予想が上期実績を下回る背景：
  - 売上高：上期の顧客による在庫積増しの反動（更にメモリ価格が調整局面に入るリスクもあり、注視が必要）  
想定為替レートの影響
  - 利益：原材料価格の動向を減益リスクとして織り込む。想定為替レートの影響

# 業績予想 (通期予想)

単位：百万円	21年3月期	22年3月期					
	通期実績	期初予想 (‘21/5)	修正予想 (‘21/8)	修正予想 (‘21/11)	前期比	期初予想比 (‘21/5)	修正予想比 (‘21/8)
売上高	41,956	43,500	47,000	<b>50,000</b>	<b>+19.2%</b>	<b>+14.9%</b>	<b>+6.4%</b>
営業利益 率	7,639 18.2%	8,500 19.5%	10,200 21.7%	<b>11,500</b> <b>23.0%</b>	<b>+50.5%</b> -	<b>+35.3%</b> -	<b>+12.7%</b> -
経常利益 率	7,709 18.4%	8,600 19.8%	10,350 22.0%	<b>11,750</b> <b>23.5%</b>	<b>+52.4%</b> -	<b>+36.6%</b> -	<b>+13.5%</b> -
当期純利益 率	5,607 13.4%	6,200 14.3%	7,400 15.7%	<b>8,800</b> <b>17.6%</b>	<b>+56.9%</b> -	<b>+41.9%</b> -	<b>+18.9%</b> -

## ・増収増益予想 (売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに、過去最高の更新を見込む)

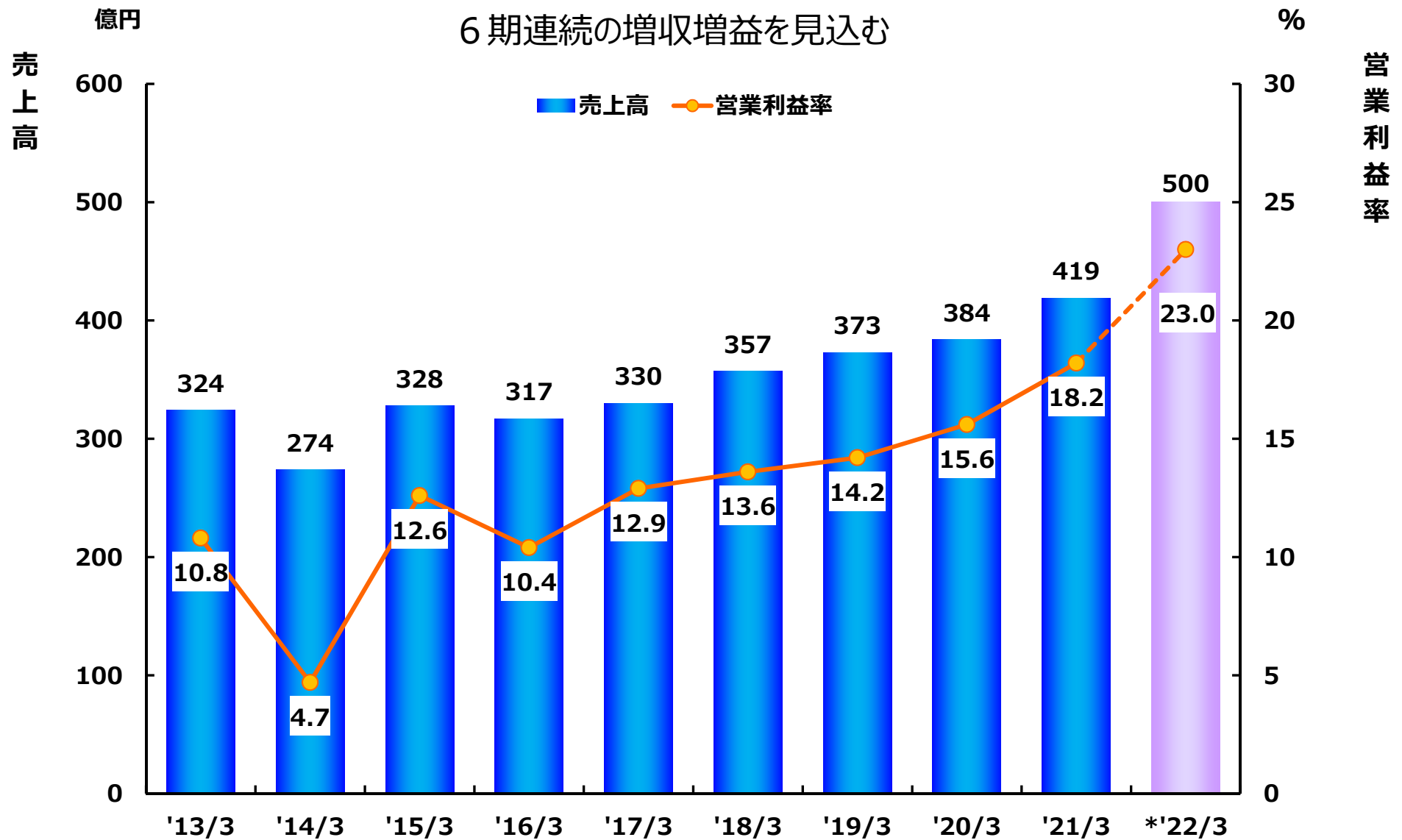
売上高：最先端半導体デバイス向け製品の需要増加に加え、自動車向け等の従来型半導体デバイスも需要回復

利益：最先端半導体関連製品の売上が増加し、製品構成が良化

用途別売上高：

- シリコン売上高：前期比+26.4%予想
- CMP売上高：前期比+18.3%予想

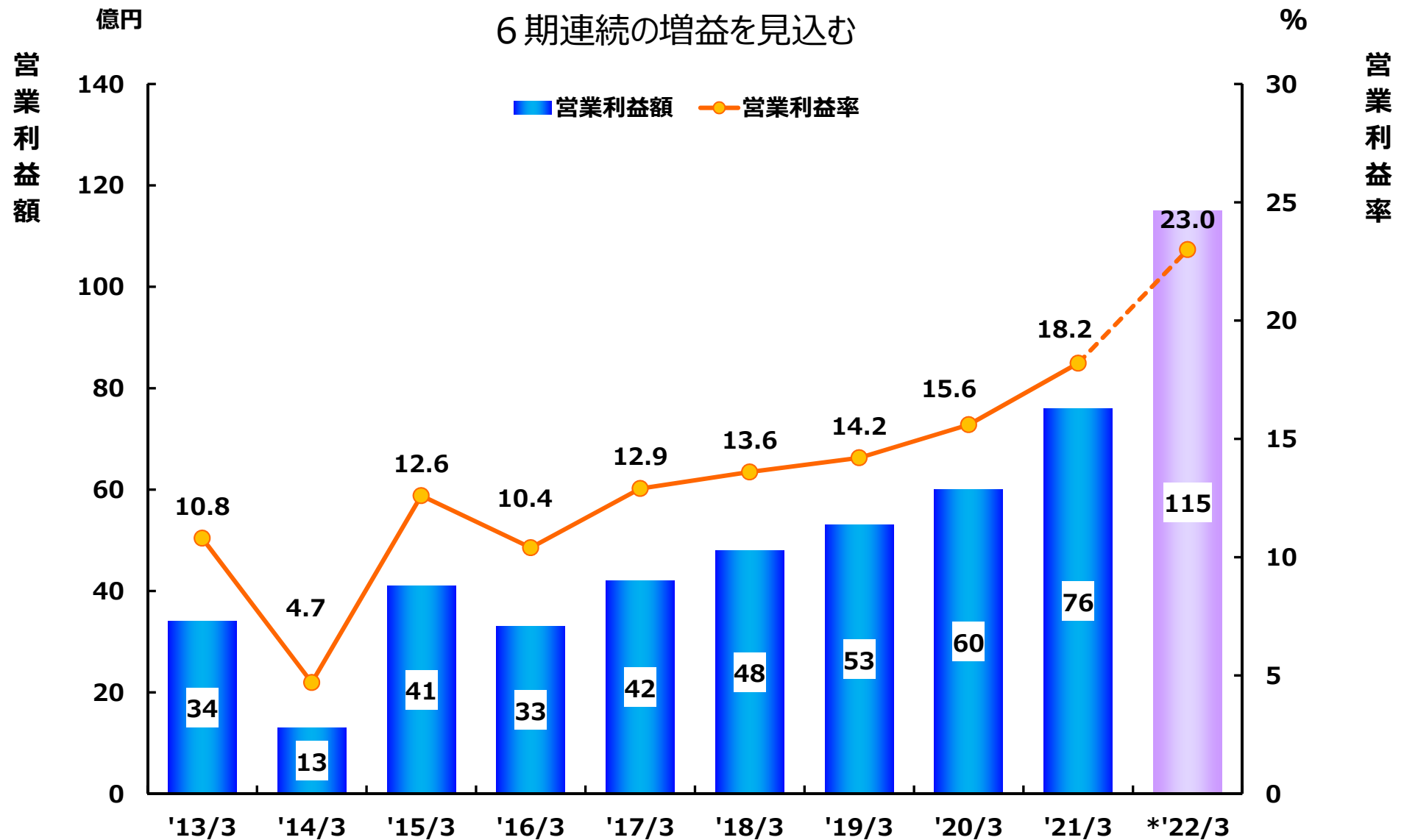
# 業績推移 (通期)



\*'22/3は予想値



# 営業利益（通期）



\*'22/3は予想値

# 用途別売上高

# 用途別売上高（上期実績）

単位：百万円		21年3月期		22年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
シリコンウェハ	ラッピング	2,158	2,446	2,300	2,985	+38.3%	+22.0%	+29.8%
	ポリシング	4,521	5,100	5,100	6,007	+32.9%	+17.8%	+17.8%
	切断	108	136	100	136	+25.3%	+0.0%	+36.5%
	計	6,788	7,683	7,500	9,129	+34.5%	+18.8%	+21.7%
CMP		10,055	9,982	10,100	12,155	+20.9%	+21.8%	+20.3%
ディスク	アルミディスク	926	741	750	770	△16.8%	+4.0%	+2.8%
	ガラスディスク	11	25	25	19	+75.0%	△21.5%	△20.1%
	計	938	766	775	790	△15.7%	+3.1%	+2.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,699	2,080	1,750	2,140	+26.0%	+2.9%	+22.3%
	一般工業用(非研磨材)	920	988	850	968	+5.2%	△2.0%	+13.9%
	計	2,619	3,068	2,600	3,109	+18.7%	+1.3%	+19.6%
製品売上高		20,401	21,501	20,975	25,185	+23.4%	+17.1%	+20.1%
商品売上高		25	27	25	106	+318.5%	+288.9%	+326.5%
売上高 合計		20,427	21,529	21,000	25,291	+23.8%	+17.5%	+20.4%

# 用途別売上高 (通期予想)

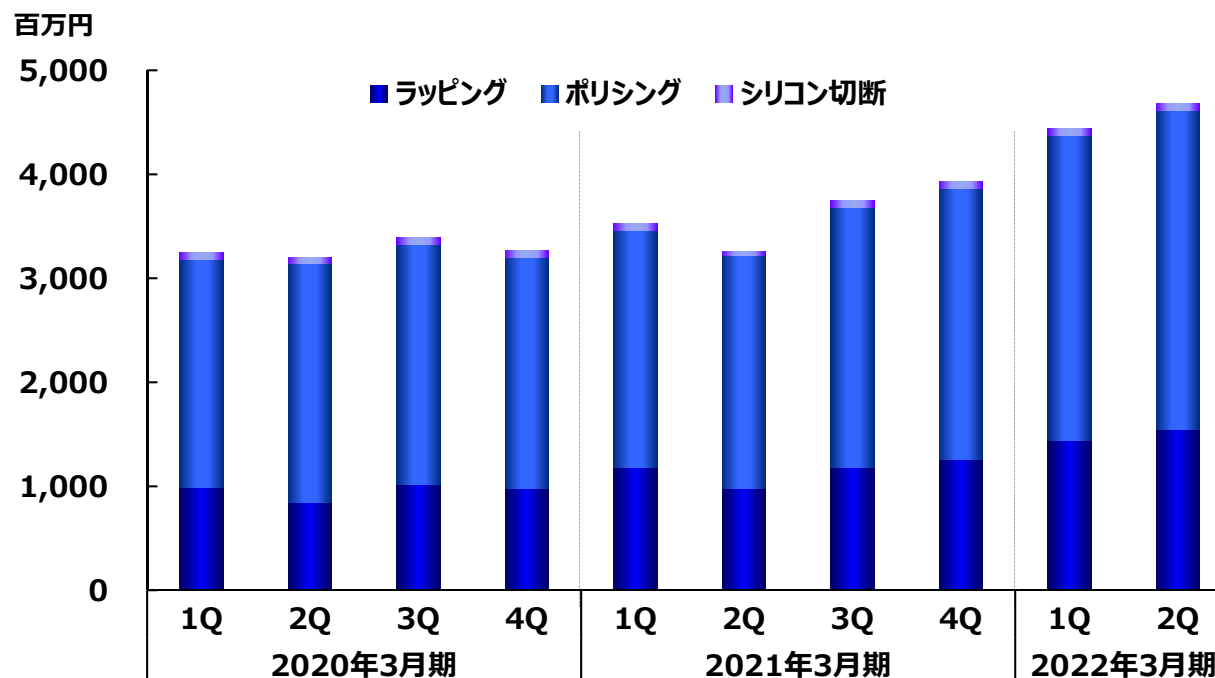
単位：百万円		20年3月期	21年3月期	22年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('21/11)	前期比	期初予想比
シリコンウエハー	ラッピング	3,838	4,604	4,650	6,000	+30.3%	+29.0%
	ポリシング	9,006	9,621	10,300	12,050	+25.2%	+17.0%
	切断	273	245	200	250	+1.8%	+25.0%
	計	13,118	14,472	15,150	18,300	+26.4%	+20.8%
CMP		17,361	20,037	21,000	23,700	+18.3%	+12.9%
ディスク	アルミディスク	1,961	1,668	1,650	1,550	△7.1%	△6.1%
	ガラスディスク	203	36	50	50	+35.7%	0.0%
	計	2,164	1,705	1,700	1,600	△6.2%	△5.9%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,571	3,779	3,700	4,300	+13.8%	+16.2%
	一般工業用(非研磨材)	1,912	1,909	1,900	1,950	+2.1%	+2.6%
	計	5,483	5,688	5,600	6,250	+9.9%	+11.6%
製品売上高		38,128	41,903	43,450	49,850	+19.0%	+14.7%
商品売上高		279	52	50	150	+183.3%	+199.8%
売上高 合計		38,408	41,956	43,500	50,000	+19.2%	+14.9%

# シリコンウェハ－売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		21年3月期		22年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
シリコンウェハ－	ラッピング	2,158	2,446	2,300	2,985	+38.3%	+22.0%	+29.8%
	ポリシング	4,521	5,100	5,100	6,007	+32.9%	+17.8%	+17.8%
	切断	108	136	100	136	+25.3%	+0.0%	+36.5%
	計	6,788	7,683	7,500	9,129	+34.5%	+18.8%	+21.7%



・事業環境：  
 - 半導体業界の高い稼働に支えられシリコンウェハ－市場は堅調  
 - シリコンウェハ－の四半期毎の出荷面積も過去最高を更新

・ラッピング向け製品：  
 上記要因により大幅増収

・ポリシング向け製品：  
 上記要因により大幅増収

(前年同期比の増加率は、顧客の在庫積増しもあり、業界成長率を超過)

# シリコンウェハ－売上高（下期予想・通期予想）

## 「下期」

単位：百万円

		21年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('21/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
シリコンウェハ－	ラッピング	2,158	2,446	2,985	2,350	3,015	+23.3%	+1.0%	+28.3%
	ポリシング	4,521	5,100	6,007	5,200	6,043	+18.5%	+0.6%	+16.2%
	切断	108	136	136	100	114	△16.5%	△16.5%	+13.8%
	計	6,788	7,683	9,129	7,650	9,171	+19.4%	+0.5%	+19.9%

## 「通期」

単位：百万円

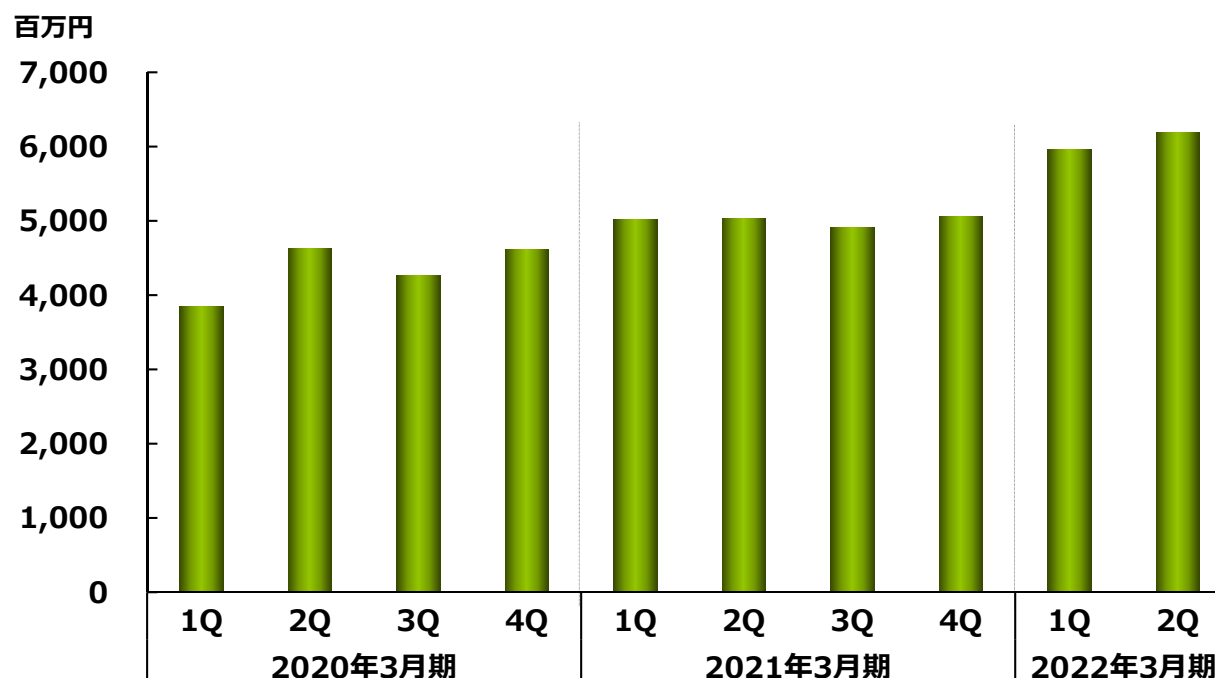
		20年3月期	21年3月期	22年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('21/11)	前期比	期初予想比
シリコンウェハ－	ラッピング	3,838	4,604	4,650	6,000	+30.3%	+29.0%
	ポリシング	9,006	9,621	10,300	12,050	+25.2%	+17.0%
	切断	273	245	200	250	+1.8%	+25.0%
	計	13,118	14,472	15,150	18,300	+26.4%	+20.8%

# CMP売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

	21年3月期		22年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
CMP	10,055	9,982	10,100	12,155	+20.9%	+21.8%	+20.3%



- ・事業環境：
  - 情報通信の高度化に伴う最先端半導体デバイスの需要増加
  - 自動車向け等の従来型半導体デバイスの需要回復
- ・CMP向け製品：
  - ロジック向け、メモリ向け製品ともに上記要因により増収

# CMP売上高（下期予想・通期予想）

## 「下期」

単位：百万円

	21年3月期		22年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('21/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
CMP	10,055	9,982	12,155	10,900	11,545	+15.7%	△5.0%	+5.9%

## 「通期」

単位：百万円

	20年3月期	21年3月期	22年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('21/11)	前期比	期初予想比
CMP	17,361	20,037	21,000	23,700	+18.3%	+12.9%



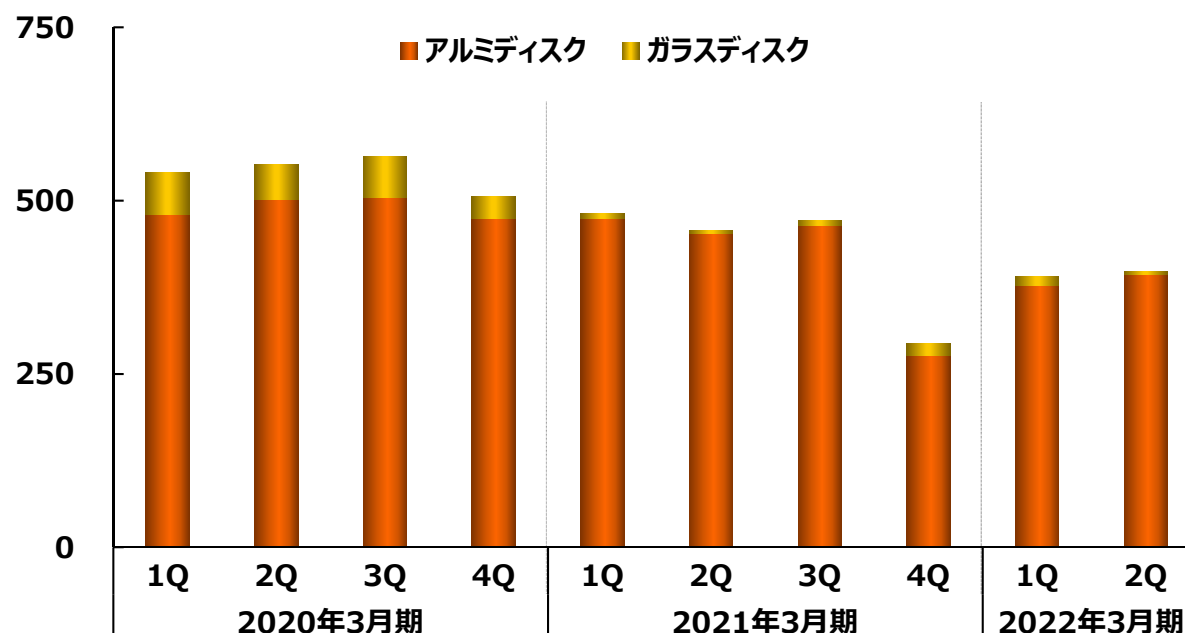
# ディスク売上高（上期実績）

「上期」

単位：百万円

		21年3月期		22年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
ディスク	アルミディスク	926	741	750	770	△16.8%	+4.0%	+2.8%
	ガラスディスク	11	25	25	19	+75.0%	△21.5%	△20.1%
	計	938	766	775	790	△15.7%	+3.1%	+2.0%

百万円



・事業環境  
 - HDDからSSDへの移行  
 - 一部顧客の事業撤退に伴う生産終了

・アルミディスク向け製品：  
 - 前年同期比：上記要因により減収

- 四半期毎の動向：在宅需要の反動によるPC向けHDDの生産調整に伴い前期4Qは大幅減収となるも、今期1Q以降はデータセンター向け需要の増加により、前期4Qから回復

# ディスク売上高（下期予想・通期予想）

## 「下期」

単位：百万円

		21年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('21/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
ディスク	アルミディスク	926	741	770	900	779	+5.1%	+1.1%	△13.4%
	ガラスディスク	11	25	19	25	31	+21.9%	+55.2%	+22.5%
	計	938	766	790	925	810	+5.6%	+2.4%	△12.5%

## 「通期」

単位：百万円

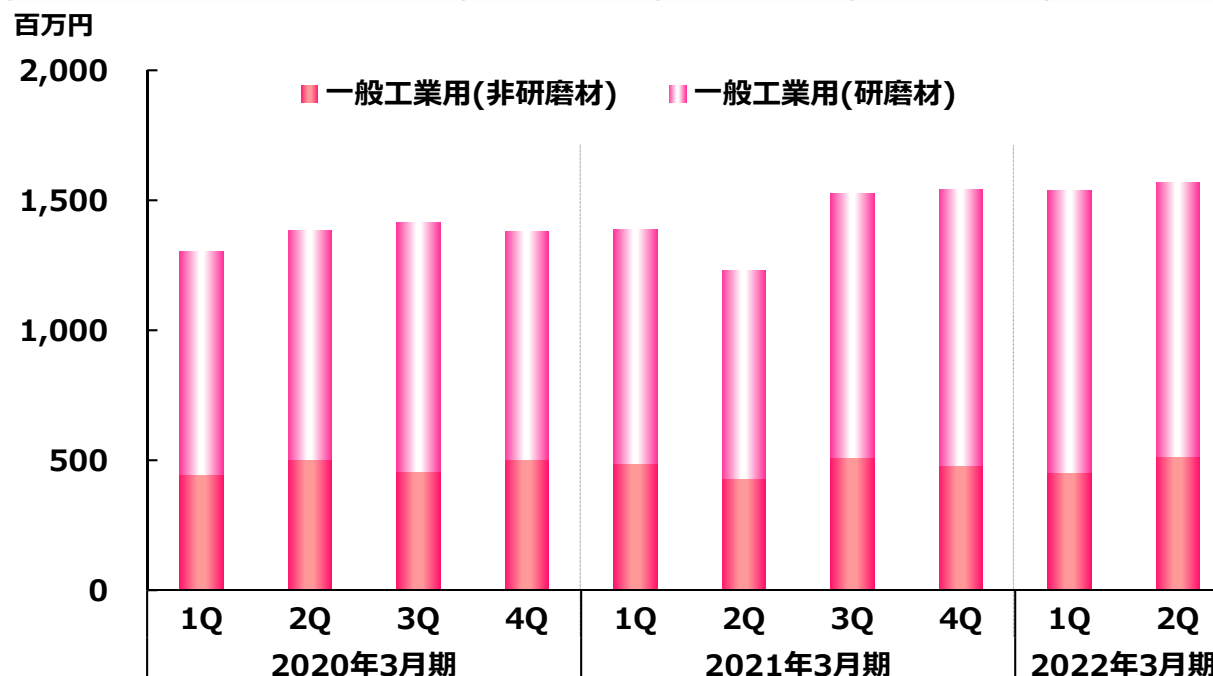
		20年3月期	21年3月期	22年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('21/11)	前期比	期初予想比
ディスク	アルミディスク	1,961	1,668	1,650	1,550	△7.1%	△6.1%
	ガラスディスク	203	36	50	50	+35.7%	0.0%
	計	2,164	1,705	1,700	1,600	△6.2%	△5.9%

# 機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		21年3月期		22年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,699	2,080	1,750	2,140	+26.0%	+2.9%	+22.3%
	一般工業用(非研磨材)	920	988	850	968	+5.2%	△2.0%	+13.9%
	計	2,619	3,068	2,600	3,109	+18.7%	+1.3%	+19.6%



- ・事業環境  
前期、コロナ感染症拡大により低迷した自動車及び産業機械市況が今期は回復
- ・一般工業用（研磨材）：  
上記要因により増収
- ・一般工業用（非研磨材）：  
- 溶射材は前年同期、前年下期に対し売上増  
- 触媒担体は前年同期、前年下期に対し売上減

# 機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

## 「下期」

単位：百万円

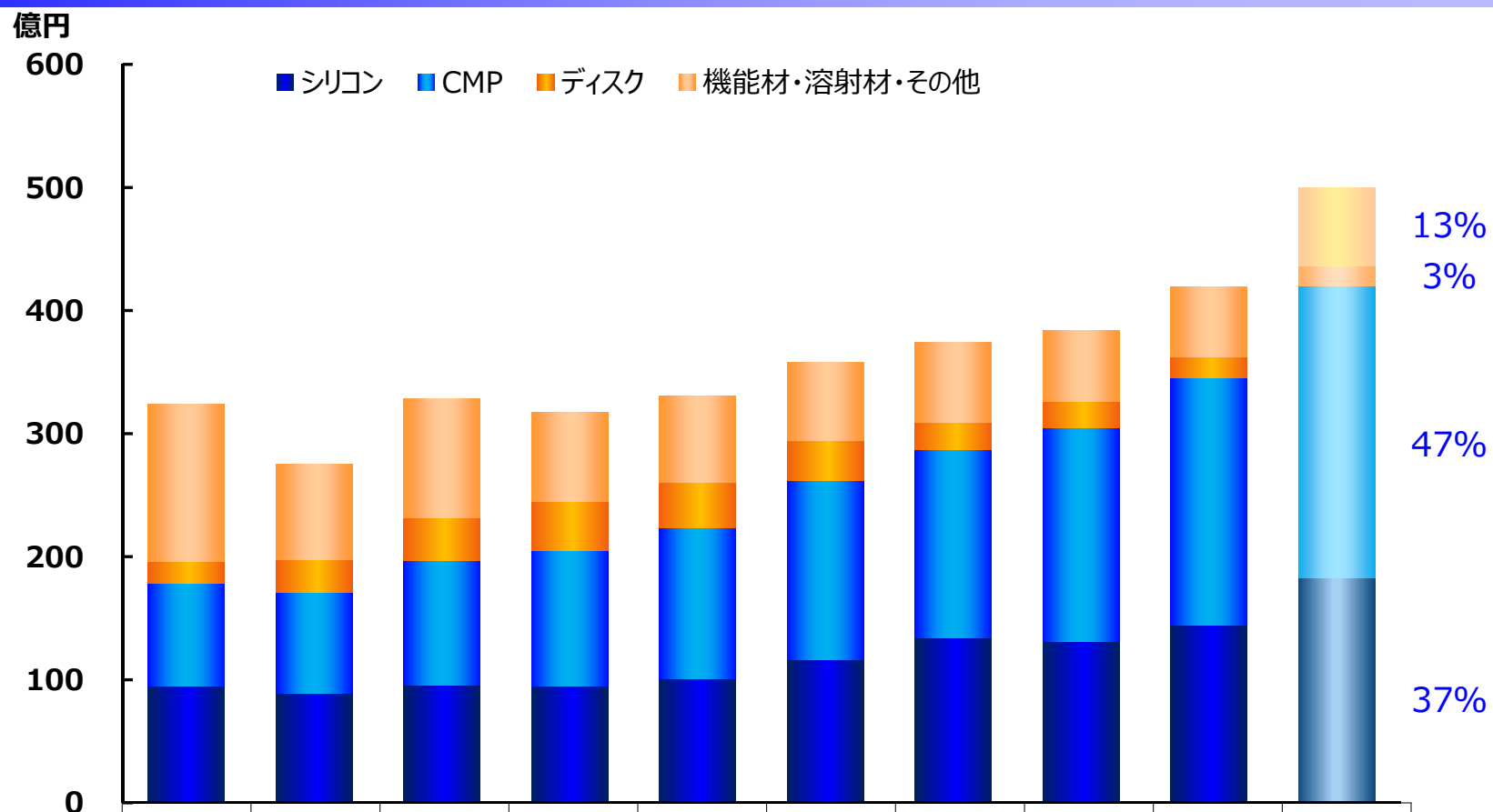
		21年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('21/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,699	2,080	2,140	1,950	2,160	+3.8%	+0.9%	+10.7%
	一般工業用(非研磨材)	920	988	968	1,050	982	△0.7%	+1.4%	△6.5%
	計	2,619	3,068	3,108	3,000	3,142	+2.4%	+1.0%	+4.7%

## 「通期」

単位：百万円

		20年3月期	21年3月期	22年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('21/11)	前期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,571	3,779	3,700	4,300	+13.8%	+16.2%
	一般工業用(非研磨材)	1,912	1,909	1,900	1,950	+2.1%	+2.6%
	計	5,483	5,688	5,600	6,250	+9.9%	+11.6%

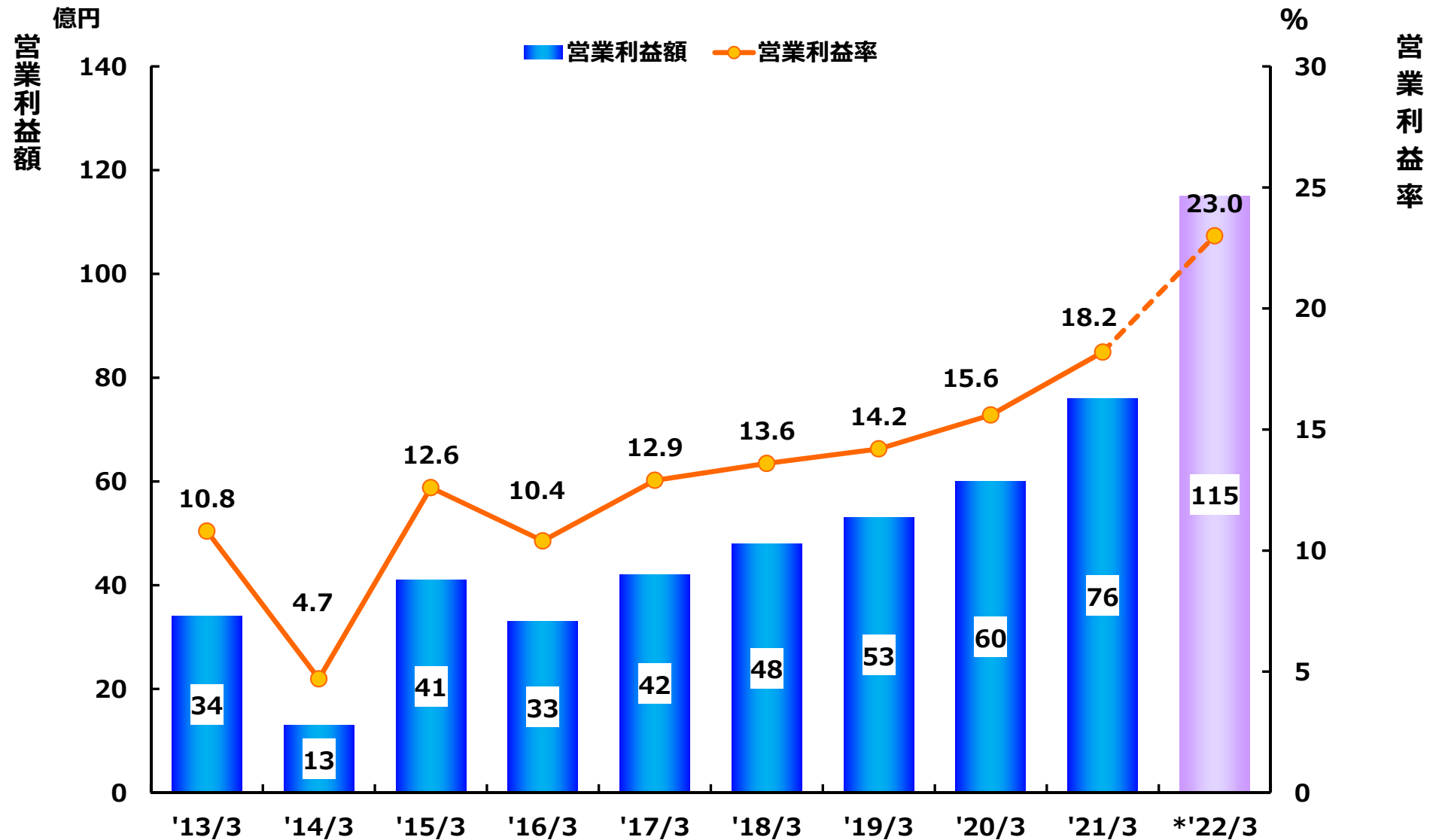
# 用途別売上高（通期）



	'13/3	'14/3	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	20/3	'21/3	*'22/3
機能材・溶射材・その他	127	77	96	72	70	63	64	57	57	64
ディスク	18	26	34	40	36	32	22	21	17	16
CMP	83	82	101	109	122	146	153	173	200	237
シリコン	94	88	95	94	100	115	133	131	144	183
計	324	274	328	317	330	357	373	384	419	500

\*'22/3は予想値

# 営業利益（通期）



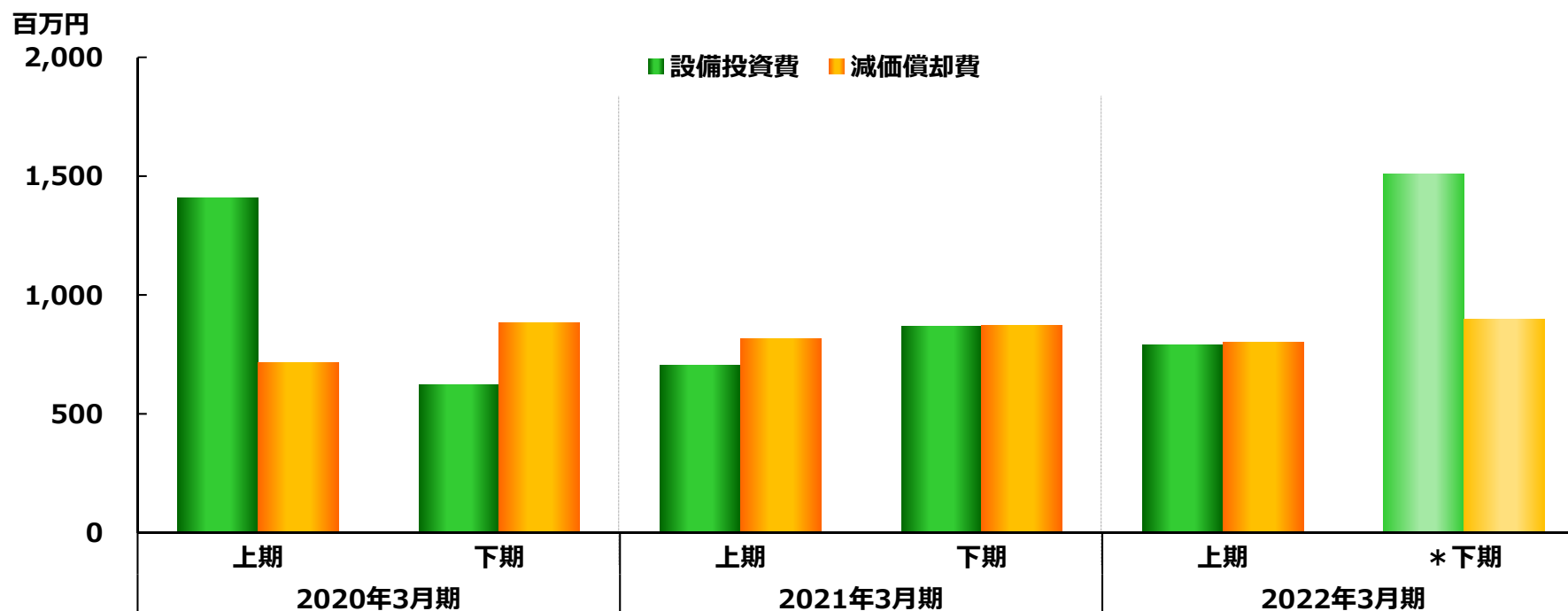
\*'22/3は予想値

設備投資額  
減価償却費  
研究開発費

# 設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	21年3月期		22年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画	上期実績	前年3月期			下期計画	下期修正計画('21/11)	前年3月期		
					前年同期比	前年下期比	計画比			前年同期比	同年上期比	計画比
設備投資額	704	870	800	789	+12.1%	△9.3%	△1.3%	1,000	1,510	+73.6%	+91.4%	+51.1%
減価償却費	815	872	800	802	△1.5%	△8.1%	+0.3%	850	897	+2.8%	+11.9%	+5.6%



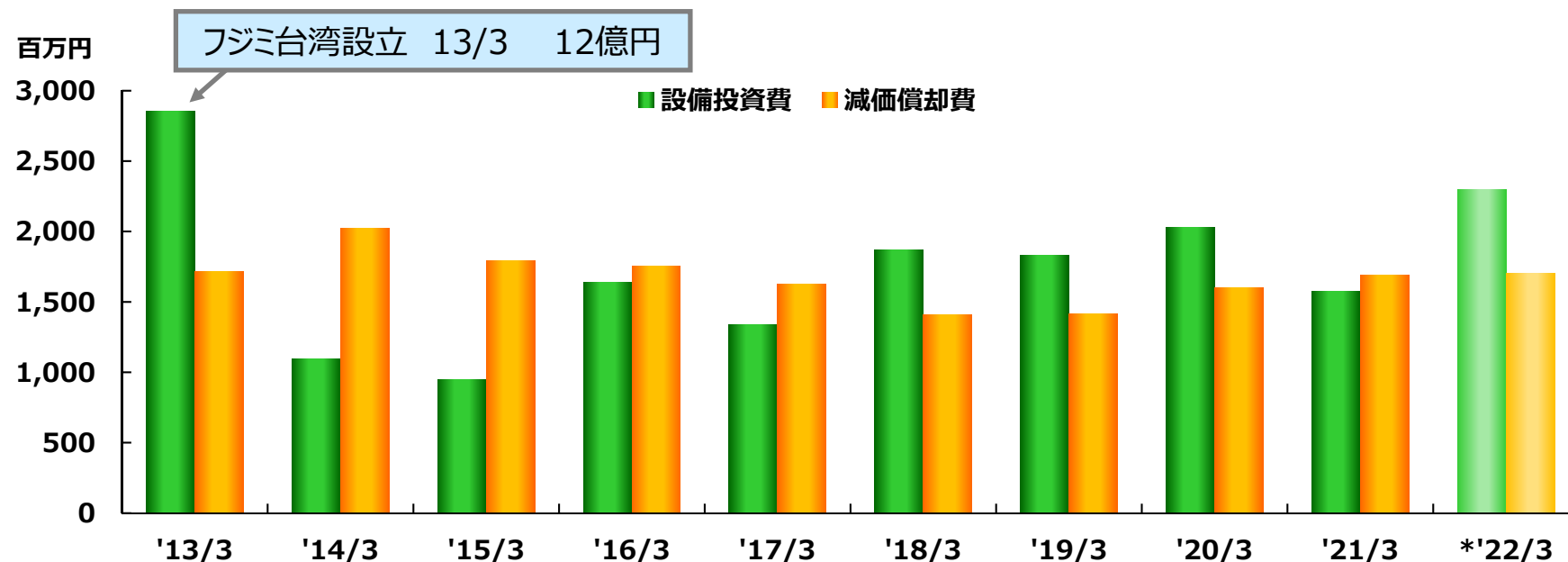
\*'22/3下期は予想値



# 設備投資額・減価償却費 (通期実績・通期計画)

単位：百万円

	21年3月期	22年3月期			
	通期実績	通期計画	通期修正計画 ('21/11)	前期比	期初計画比
設備投資	1,574	1,800	2,300	+46.1%	+27.8%
減価償却費	1,687	1,650	1,700	+0.7%	+3.0%

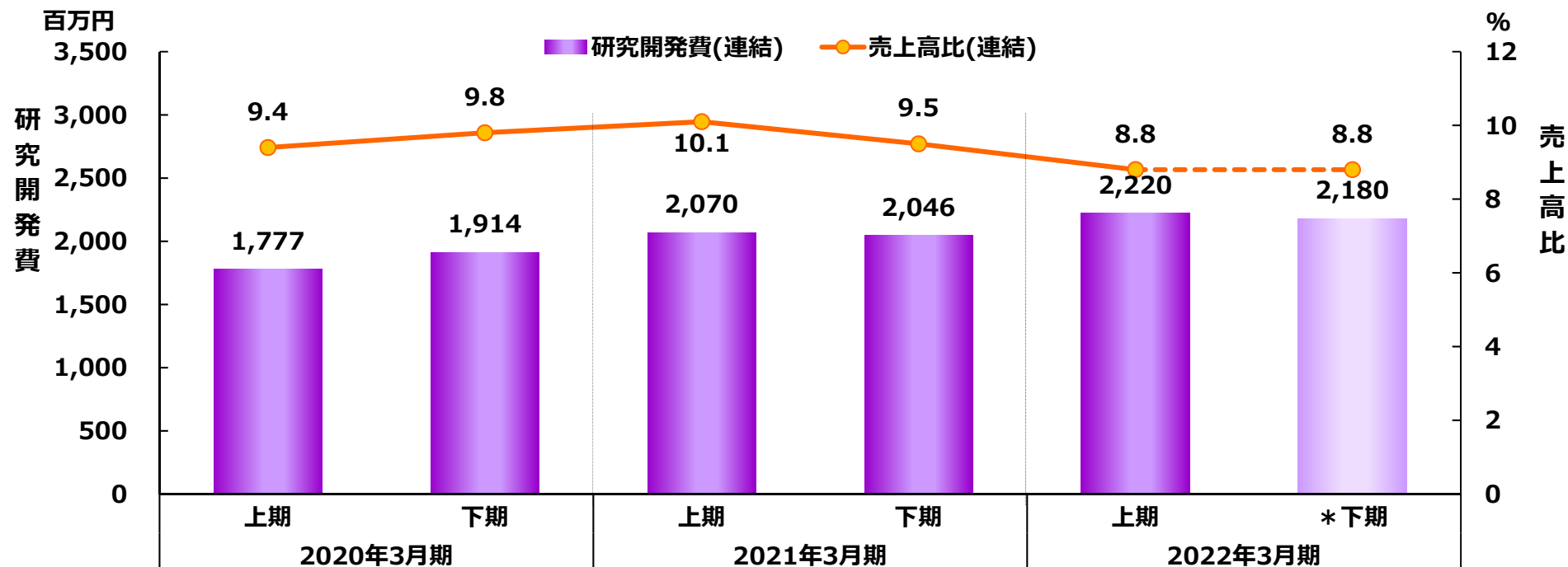


\*'22/3は予想値

# 研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	21年3月期		22年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画	上期実績	前年			下期計画	下期修正計画 ('21/11)	前年		計画比
					同期比	下期比	計画比			同期比	上期比	
研究開発費	2,070	2,046	2,100	2,220	+7.3%	+8.5%	+5.8%	2,100	2,180	+6.5%	△1.8%	+3.8%

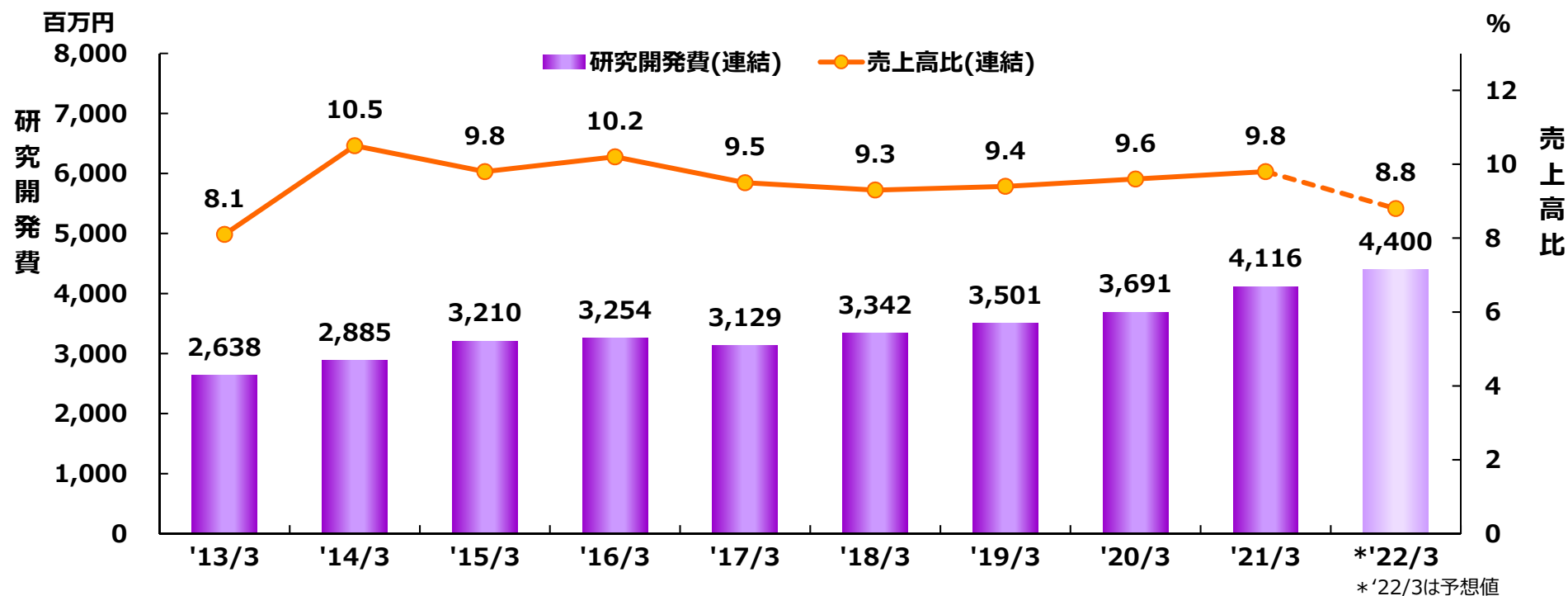


\*'22/3下期は予想値

# 研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

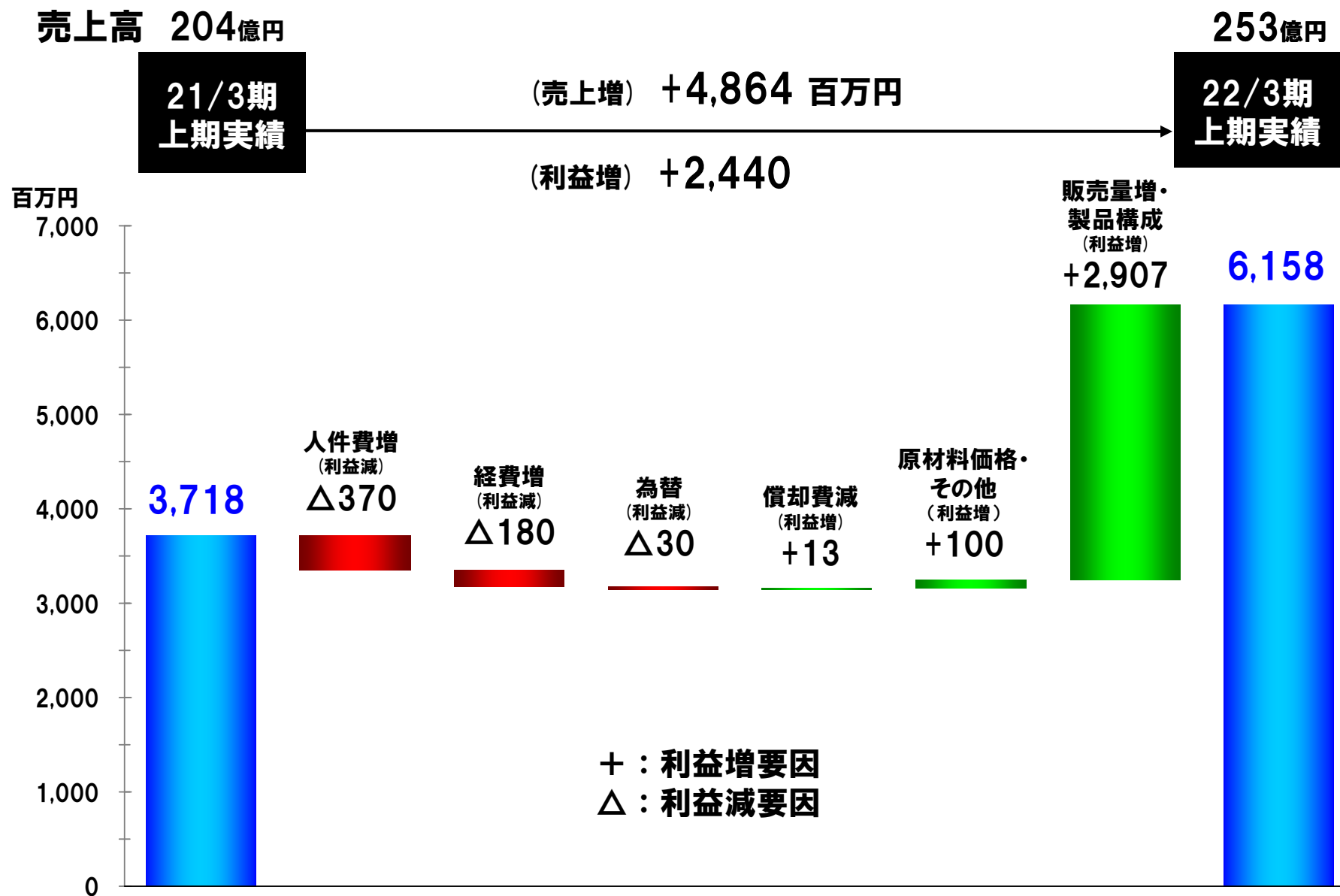
	21年3月期	22年3月期			
	通期実績	通期計画	通期修正計画('21/11)	前期比	期初計画比
研究開発費	4,116	4,200	4,400	+6.9%	+4.8%



# 損益分析

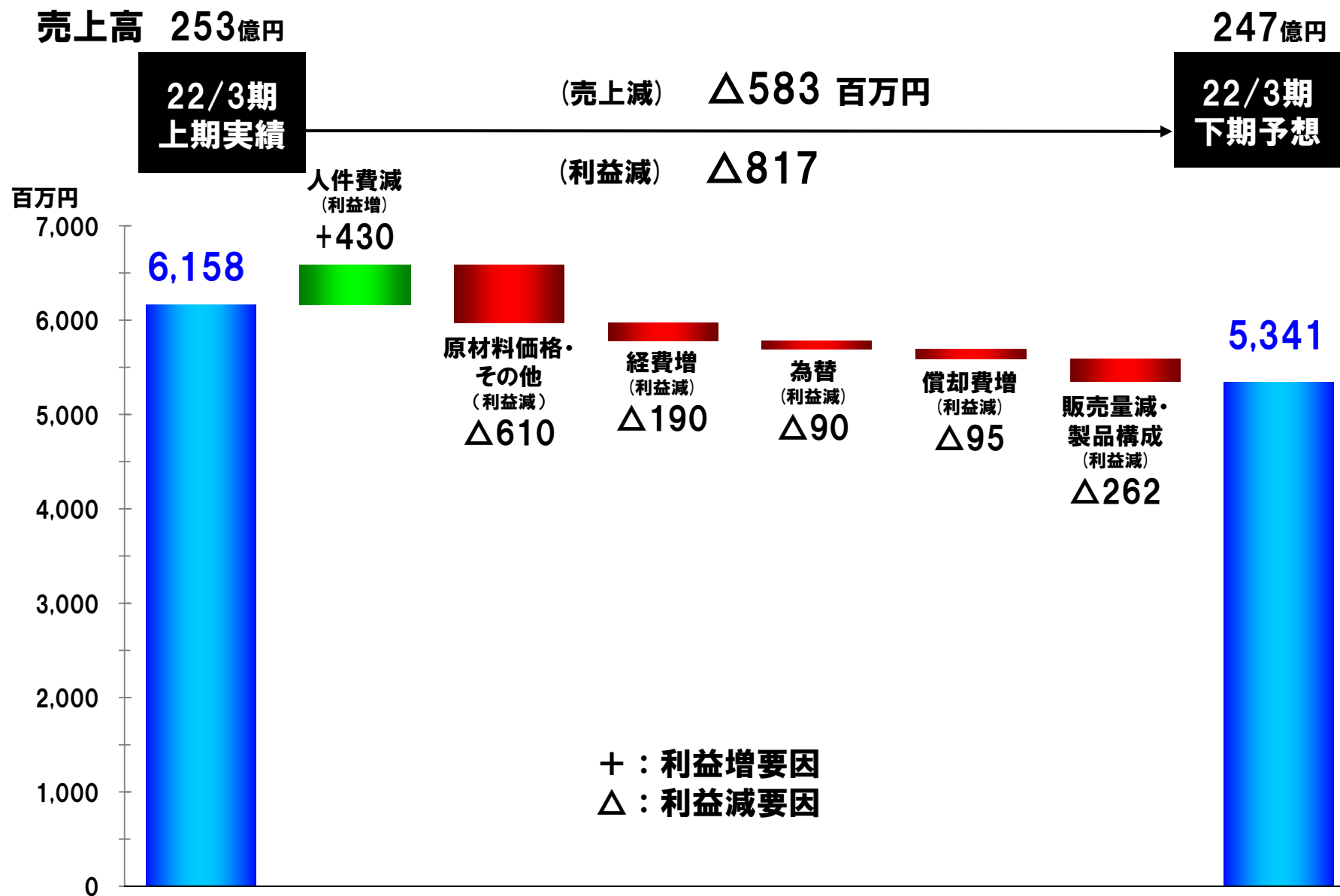
# 営業利益増減要因

21/3期上期実績 → 22/3期上期実績



# 営業利益増減要因

22/3期上期実績 → 22/3期下期予想



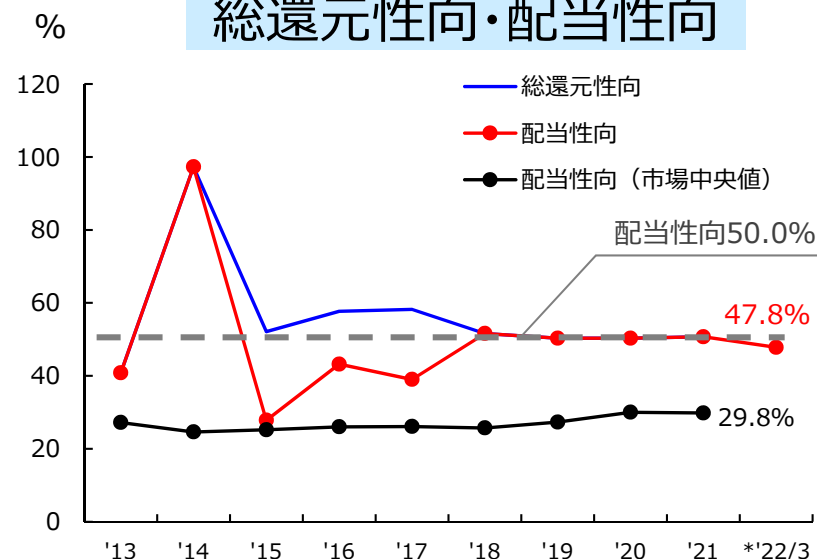
# 株主還元

# 積極的な株主還元と安定配当の継続

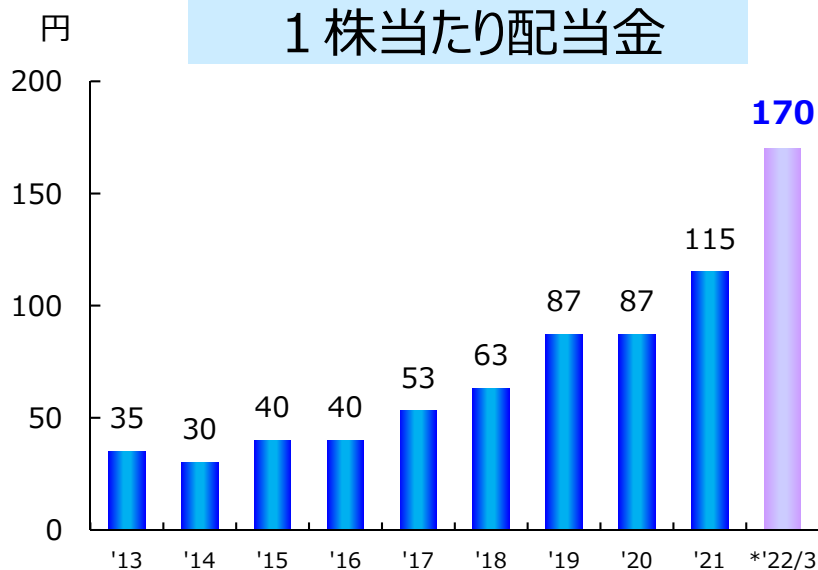
## 1株当たり当期純利益



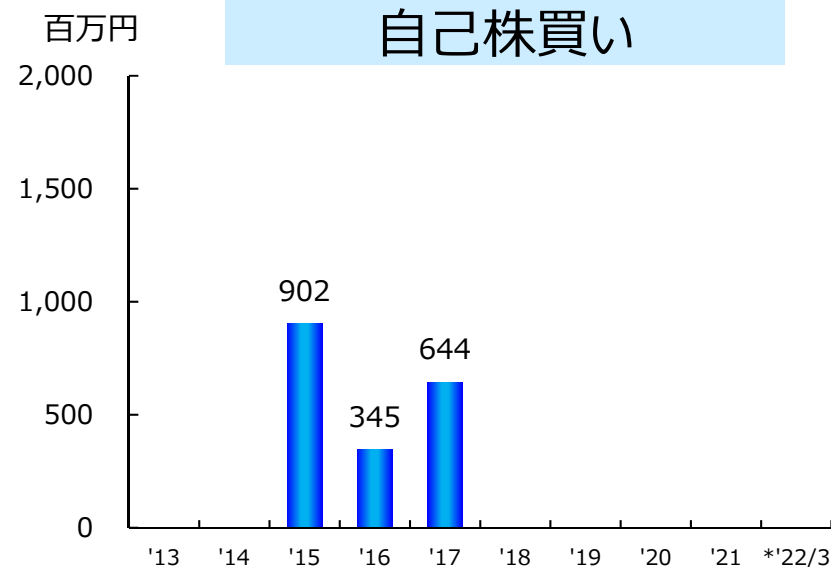
## 総還元性向・配当性向



## 1株当たり配当金



## 自己株買い



\*'22/3は予想



## 2021年3月期 上期業績サマリー／通期業績予想

### 【2021年3月期 上期業績】

✓ 売上高	+23.8%*	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が好調 <b>上期過去最高を更新</b>
✓ 営業利益	+65.6%	: 最先端半導体関連製品の売上増加に加え、製品構成が良化
✓ 経常利益	+72.1%	:
✓ 四半期純利益	+68.2%	: <b>営業利益、経常利益、四半期純利益ともに上期過去最高を更新</b>
✓ シリコンウェハー向け	+34.5%	: 半導体業界の高稼働と顧客の在庫積増しによりラッピング・ポリシングは大幅増
✓ CMP向け	+20.9%	: メモリ・ロジックともに最先端向け製品の販売増加
✓ ハードディスク向け	△15.7%	: HDDからSSDへの移行及び一部顧客の事業撤退に伴う生産終了により減収
✓ 一般工業用向け	+18.7%	: 自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
✓ 株主還元		: 業績の上振れに伴い、1株当たり配当額を期初予想65円から85円に増配 (前年同期50円)

### 【2022年3月期 通期業績予想】

✓ 売上高	+19.2%	: 最先端半導体関連製品の販売増加で <b>14期ぶりの過去最高を見込む</b>
✓ 営業利益	+50.5%	: 最先端半導体向け売上増加に加え、製品構成が良化
✓ 経常利益	+52.4%	:
✓ 当期純利益	+56.9%	: <b>営業利益・経常利益・当期純利益ともに3期連続となる過去最高を見込む</b>

\*前期同期比

# 補足資料

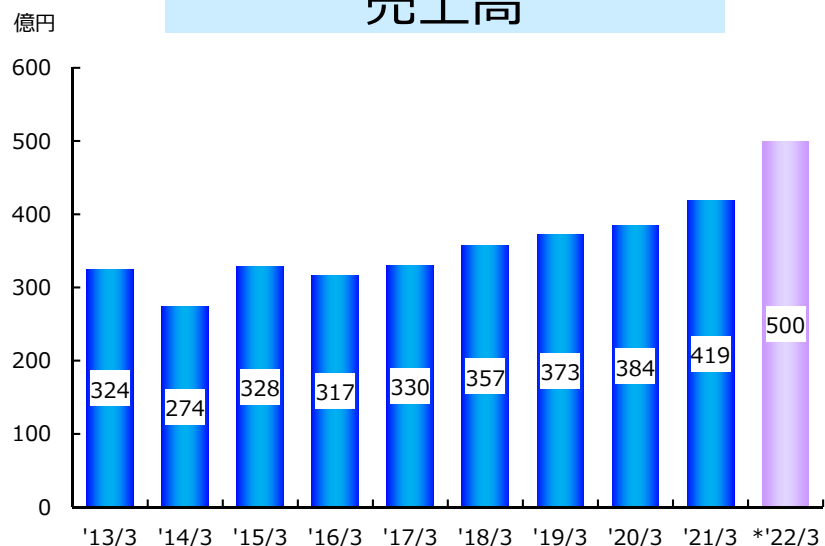
# グループ人員 内訳

(人数)	21年3月期 (3月31日現在)		22年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 *	正社員	臨時 雇用者 *	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	670	187	681	205	+11	+18
フジミコーポレーション	117	2	114	4	△3	+2
フジミ台湾	91	2	90	2	△1	—
フジミマイクロテクノロジー	69	4	68	4	△1	—
フジミヨーロッパ	5	2	4	2	△1	—
フジミ韓国	4	1	1	1	△3	—
フジミ深圳	2	1	3	1	+1	—
合 計	958	199	961	219	+3	+20

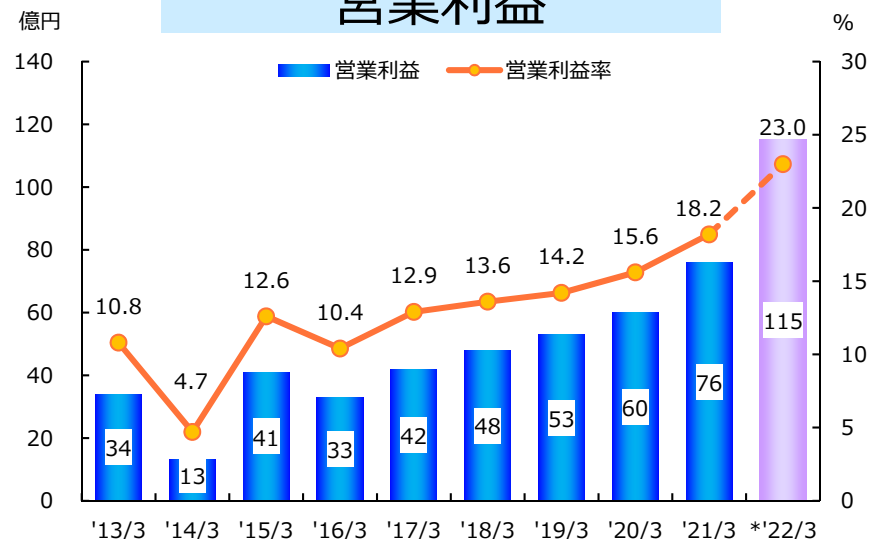
\* 臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

# 業績推移 (通期)

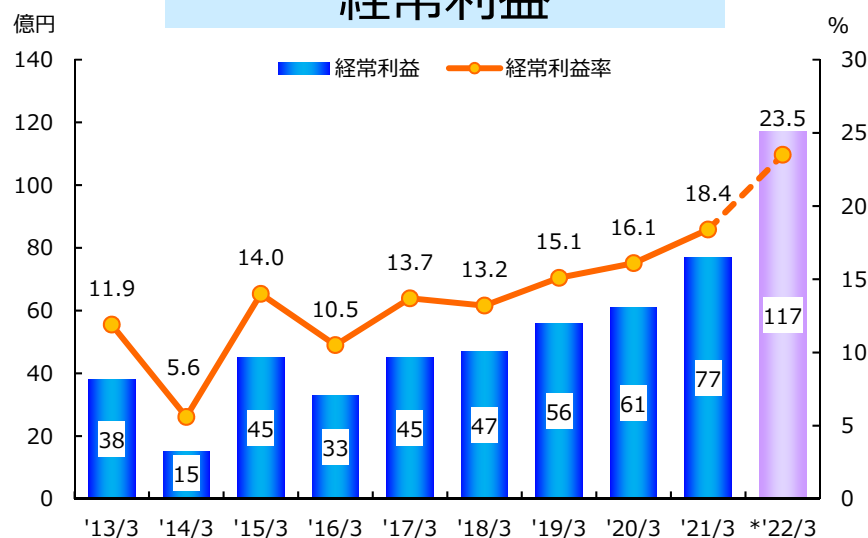
## 売上高



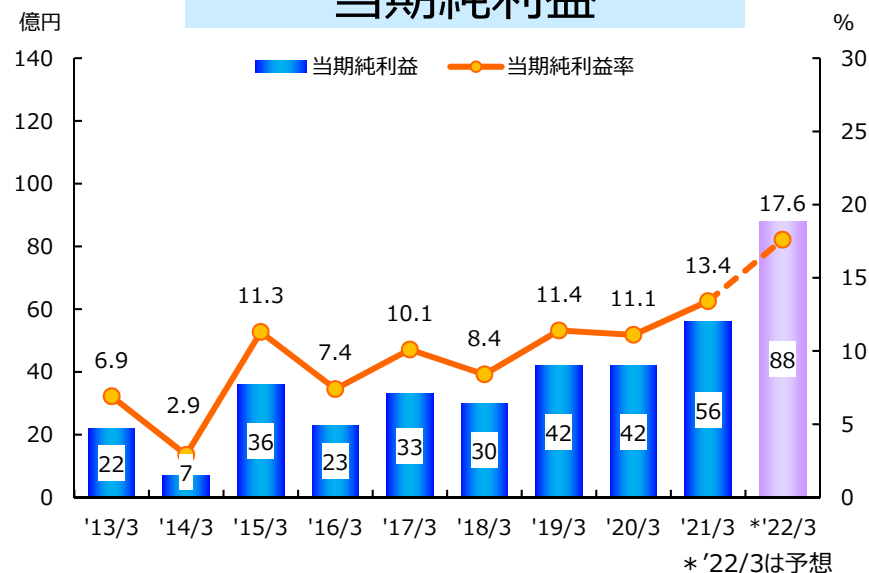
## 営業利益



## 経常利益



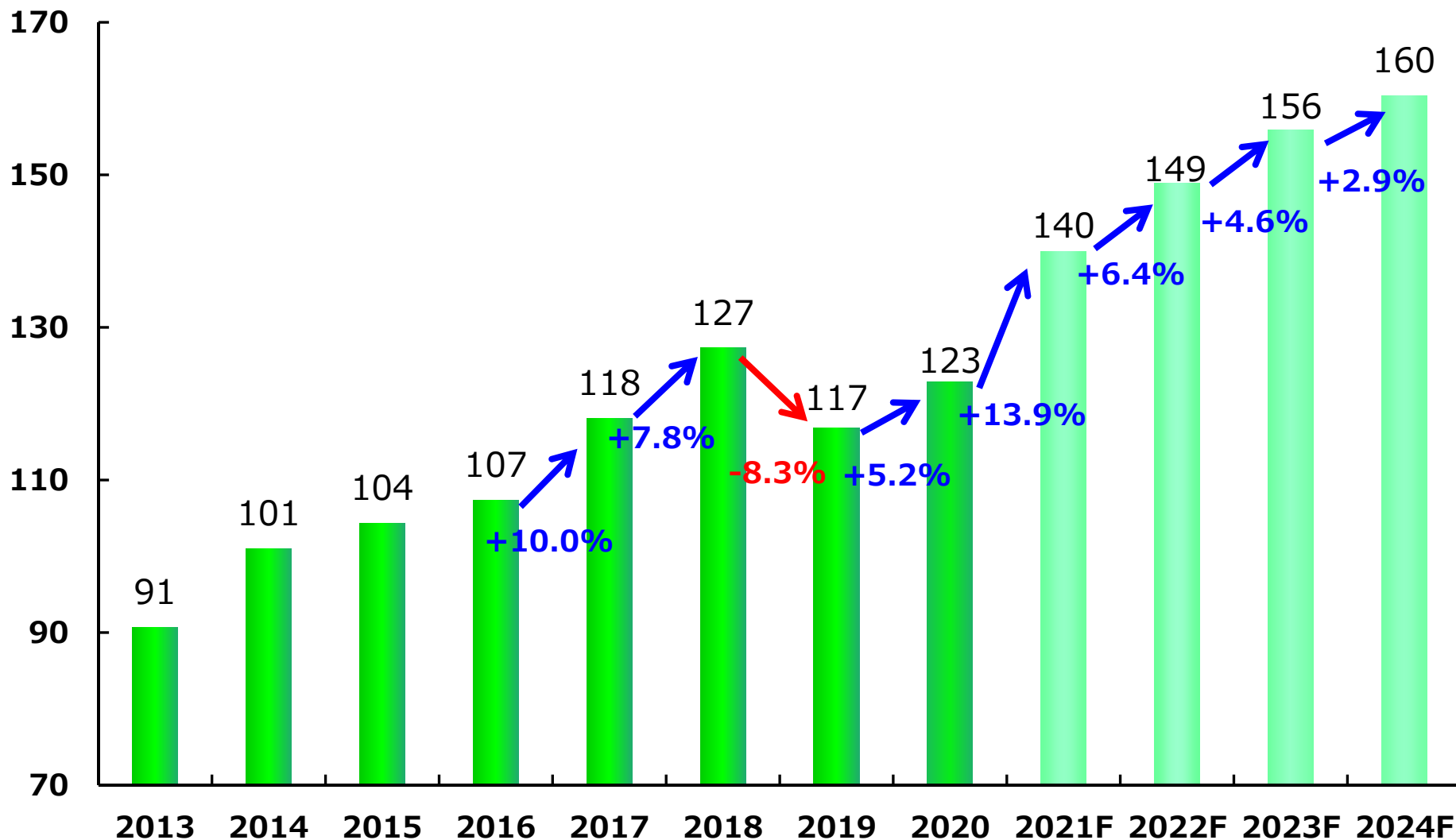
## 当期純利益



\*'22/3は予想

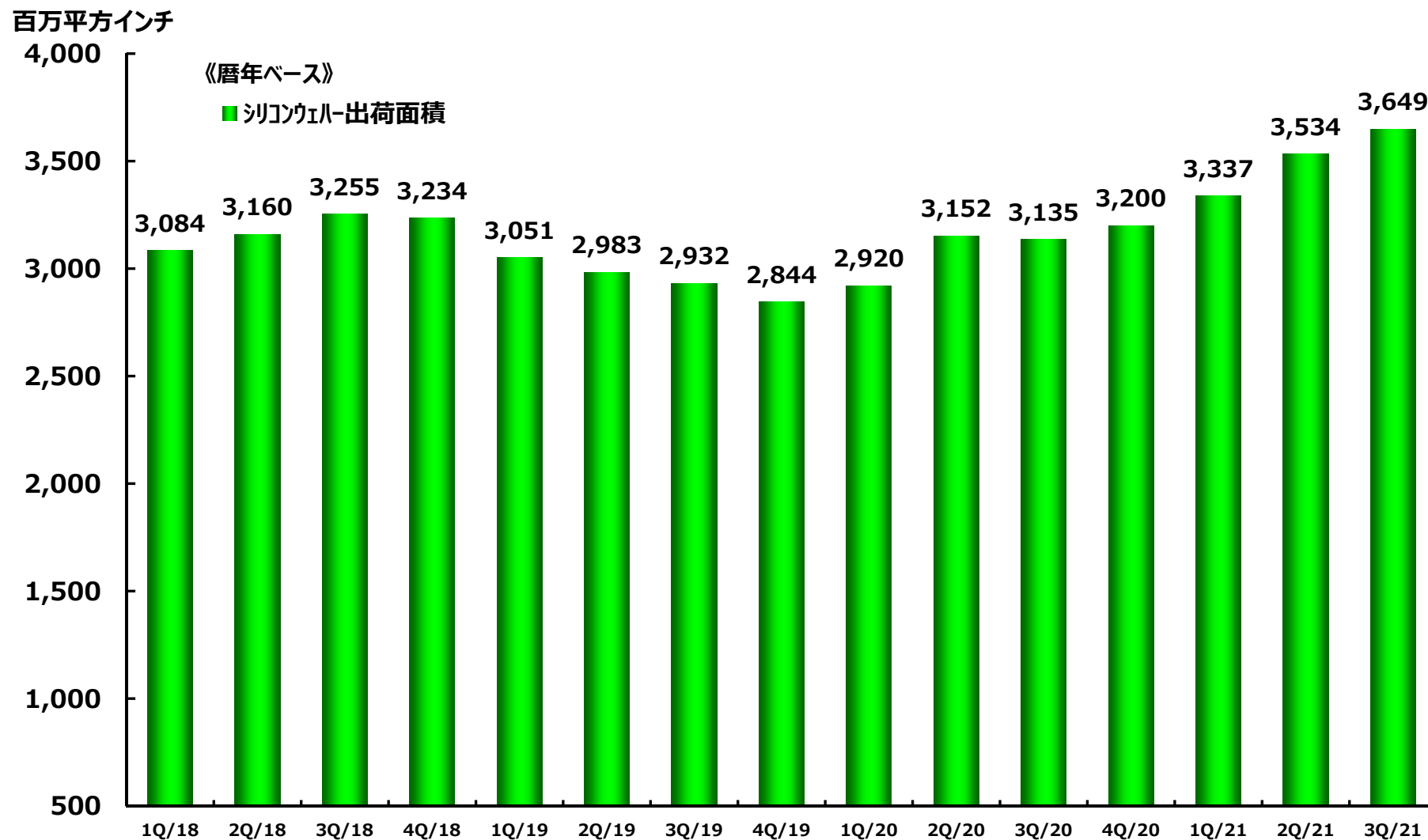
# シリコンウェハ－需要予測（出荷面積換算 全口径）

億平方インチ



出所：SEMI 2021/10/18

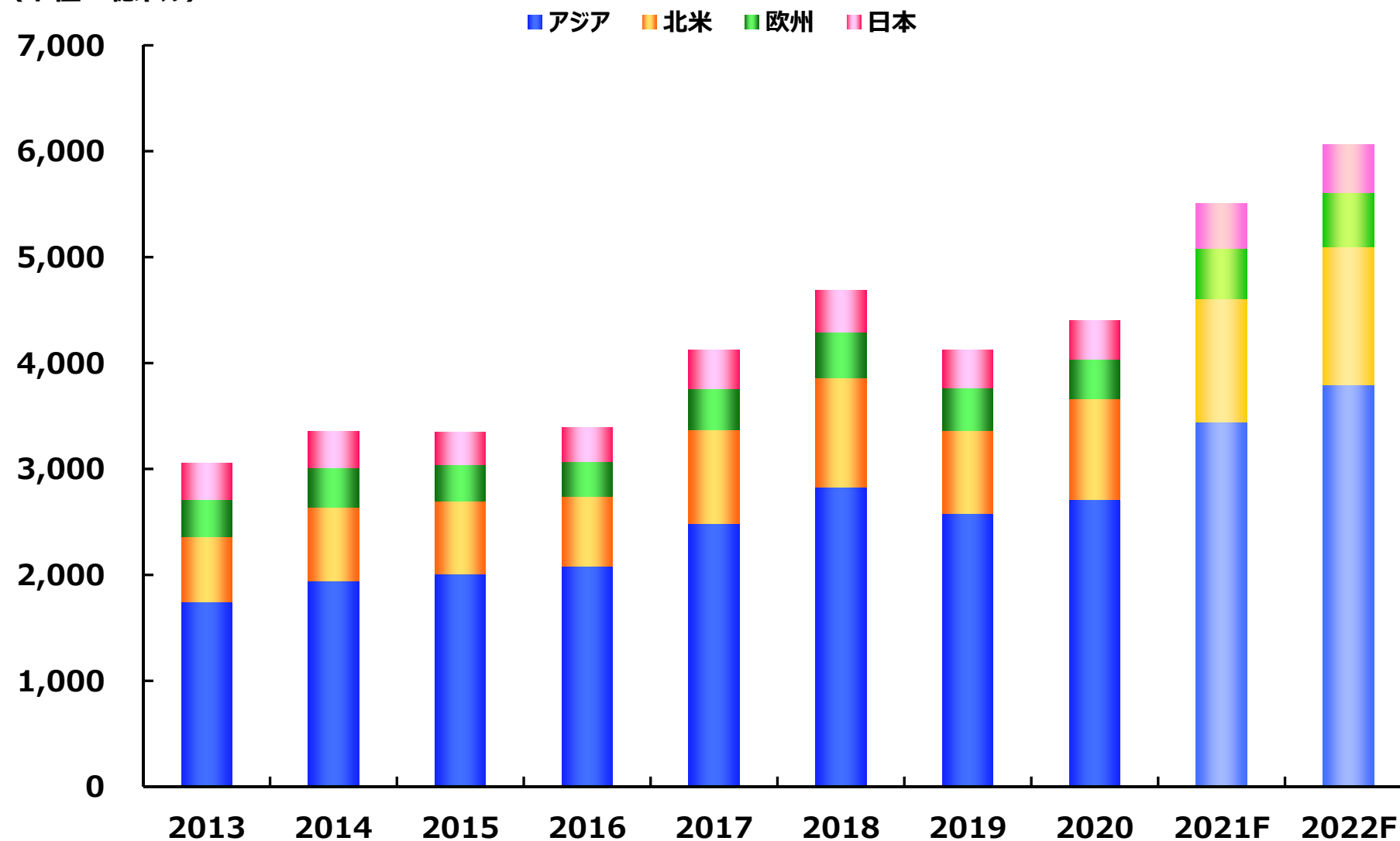
# シリコンウェハー出荷面積 (四半期)



出所：SEMI (2021/11/5)

# 半導体市場規模 (地域別)

(単位：億ドル)



出所：WSTS (2021/8/16)

Copyright(c) 2021 Fujimi Incorporated. All rights reserved.